

2026年7月期 決算説明会（2025年8月～2026年7月）

決算概要 事業環境および業績予想

サムコ株式会社 東証プライム市場 証券コード：6387

2026年9月15日（火）

<https://www.samco.co.jp/ir/>

将来の見通しに関する記述について

本資料の将来の見通しに関する記述は、作成時点で入手可能な情報に基づいた当社の予測です。
既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因によって、実際の業績が大きく異なる可能性があります。

目次

1. 2026年7月期 決算概要
2. 2027年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料



ALE装置（原子層エッチング装置）
「RIE-400iP」

2反応室ALD装置（原子層堆積装置）
「AD-8002LPC」

目次

1. 2026年7月期 決算概要
2. 2027年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料



ALE装置（原子層エッチング装置）
「RIE-400iP」

2反応室ALD装置（原子層堆積装置）
「AD-8002LPC」

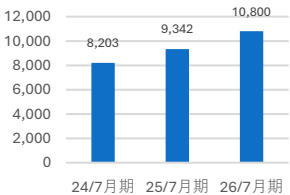
26/7月期 業績ハイライト

売上高

108.0 億円

前年同期比 +15.6%

6期連続増収・過去最高

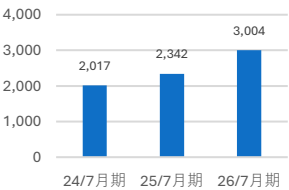


営業利益

30.0 億円

前年同期比 +28.2%

6期連続増益・過去最高

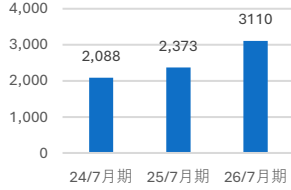


経常利益

31.1 億円

前年同期比 +31.0%

6期連続増益・過去最高

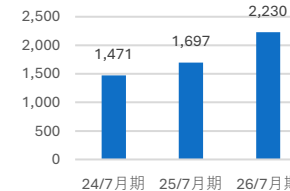


当期純利益

22.3 億円

前年同期比 +31.4%

6期連続増益・過去最高

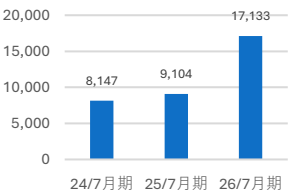


受注高

171.3 億円

前年同期比 +88.2%

過去最高

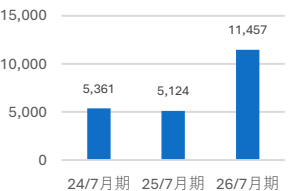


受注残高

114.5 億円

前年同期比 +123.6%

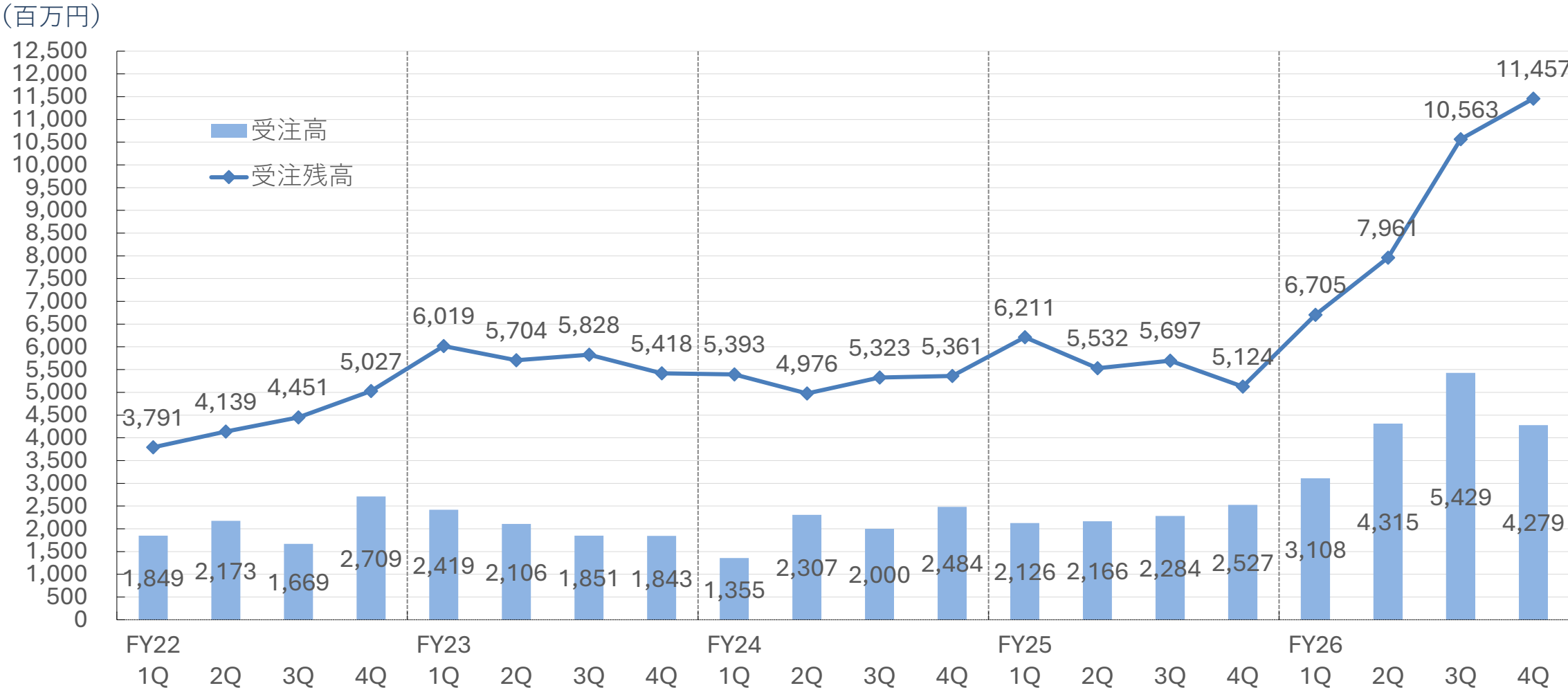
過去最高



26/7月期 決算概要

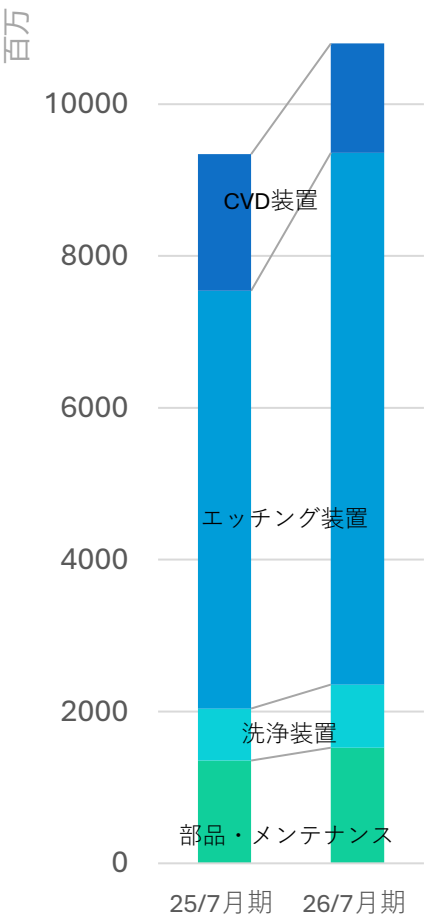
				(百万円)	
	25/7月期	26/7月期	前年同期比	2025年9月 発表 業績予想	2026年6月 発表 業績予想
売上高	9,342	10,800	15.6%	10,200	10,785
売上総利益	4,668	5,535	18.6%	4,990	5,282
売上高総利益率	50.0%	51.3%	-	49.0%	49.0%
営業利益	2,342	3,004	28.2%	2,460	2,631
営業利益率	25.1%	27.8%	-	24.2%	24.4%
経常利益	2,373	3,110	31.0%	2,440	2,722
当期純利益	1,697	2,230	31.4%	1,720	1,919
受注高	9,104	17,133	88.2%		
受注残高	5,124	11,457	123.6%		

受注高と受注残高推移

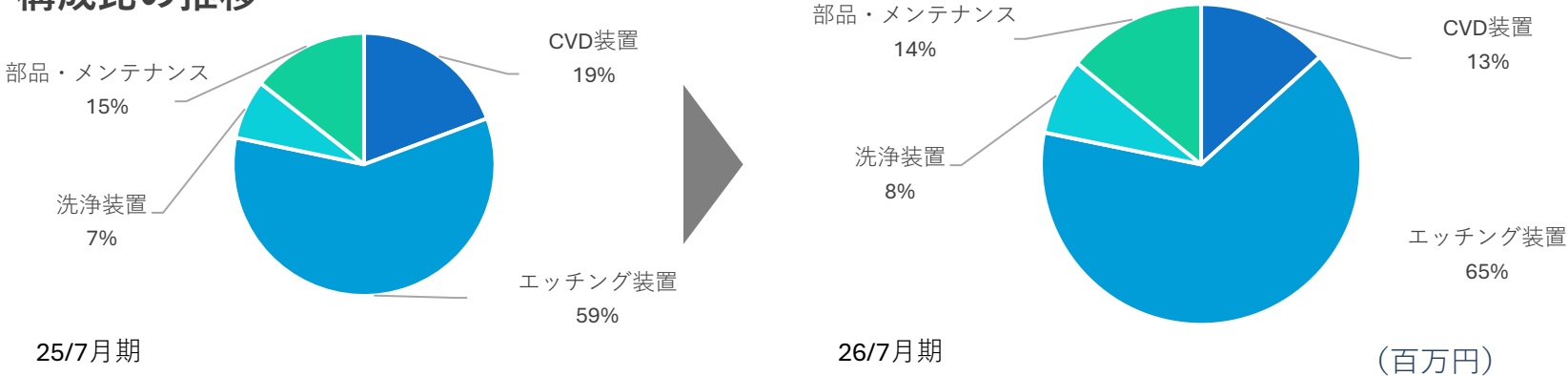


26/7月期 装置別売上高

売上高の推移



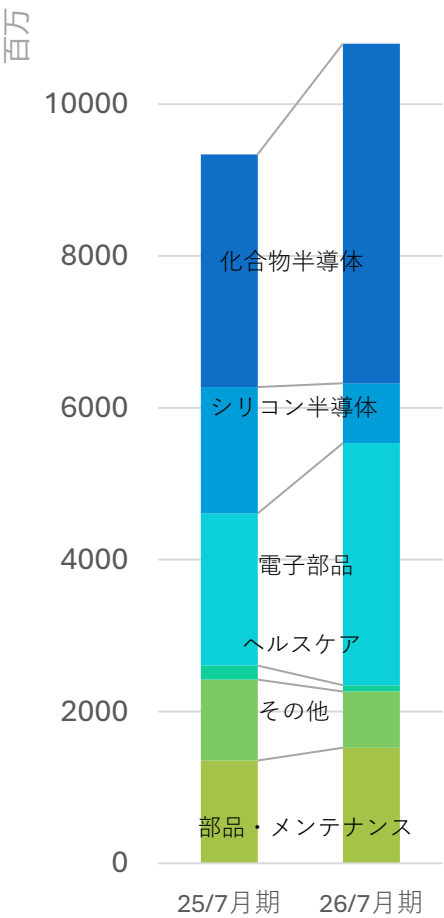
構成比の推移



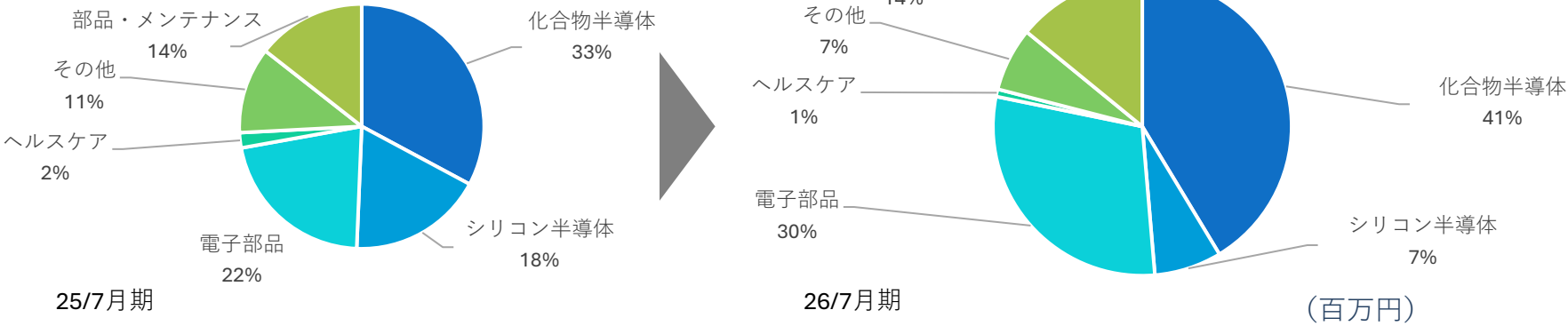
	25/7月期		26/7月期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	前年同期比
CVD装置	1,799	19.3%	1,440	13.3%	△20.0%
エッチング装置	5,503	58.9%	7,004	64.9%	+27.3%
洗浄装置	685	7.3%	832	7.7%	+21.4%
部品・メンテナンス	1,354	14.5%	1,523	14.1%	+12.5%
合計	9,342	100.0%	10,800	100.0%	+15.6%

26/7月期 用途別売上高

売上高の推移



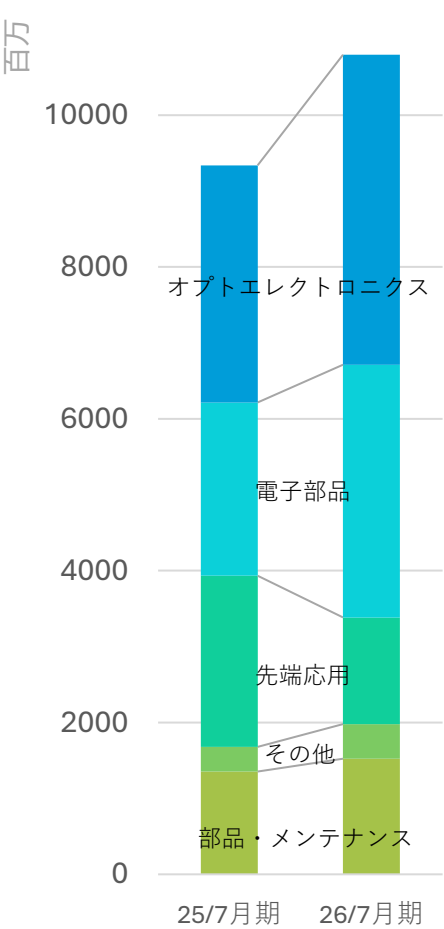
構成比の推移



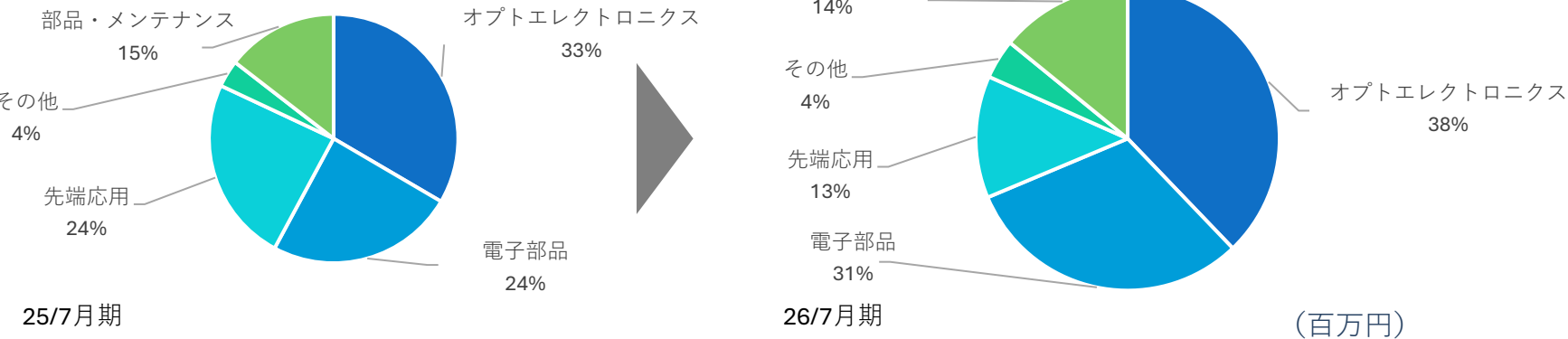
	25/7月期		26/7月期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	前年同期比
化合物半導体分野	3,066	32.8%	4,474	41.4%	+45.9%
シリコン半導体分野	1,665	17.8%	787	7.3%	△52.7%
電子部品分野	2,004	21.5%	3,191	29.6%	+59.2%
ヘルスケア分野	185	2.0%	83	0.8%	△55.2%
その他分野	1,066	11.4%	740	6.9%	△30.6%
部品・メンテナンス	1,354	14.5%	1,523	14.1%	+12.5%
合計	9,342	100.0%	10,800	100.0%	+15.6%

26/7月期 新用途別売上高

売上高の推移



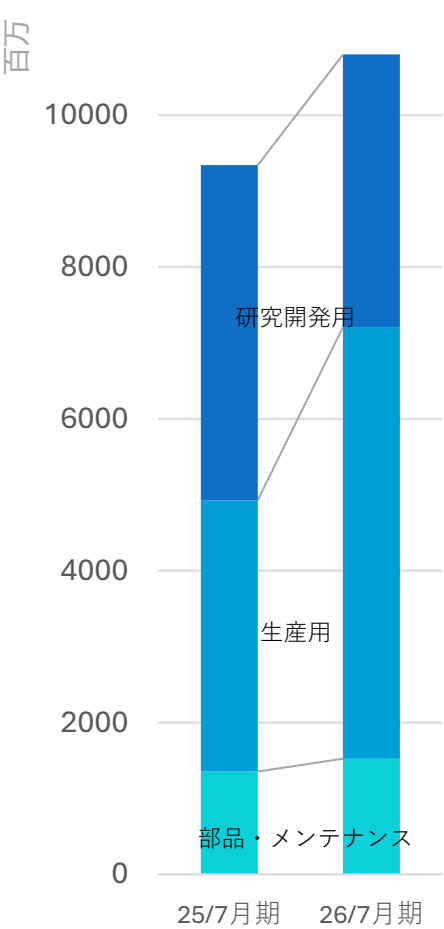
構成比の推移



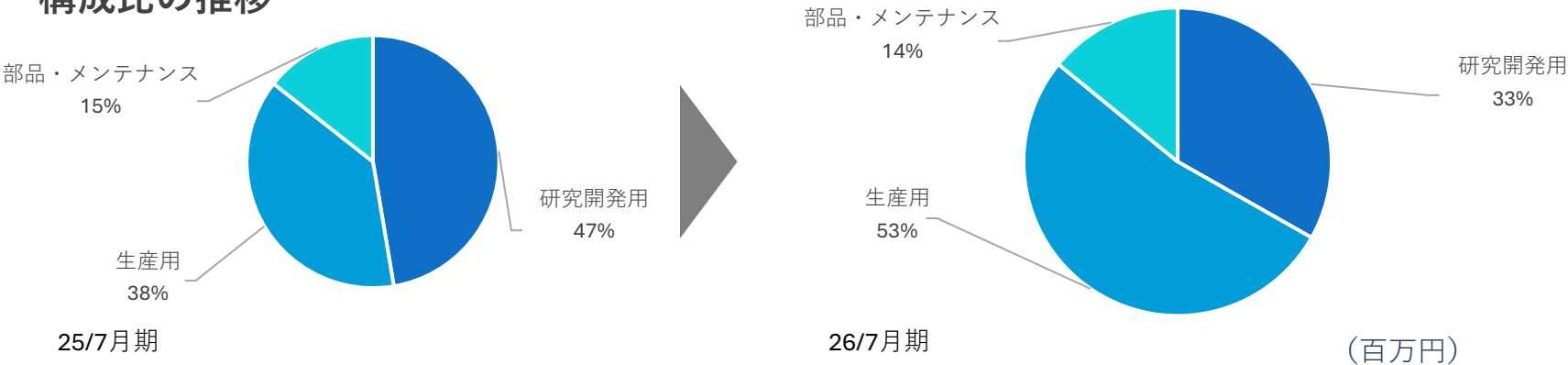
	25/7月期		26/7月期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	前年同期比
オプトエレクトロニクス分野	3,124	33.4%	4,084	37.8%	+30.7%
電子部品分野	2,283	24.4%	3,329	30.8%	+45.8%
先端応用分野	2,254	24.1%	1,405	13.0%	△37.6%
その他分野	325	3.5%	456	4.2%	+40.2%
部品・メンテナンス	1,354	14.5%	1,523	14.1%	+12.5%
合計	9,342	100.0%	10,800	100.0%	+15.6%

26/7月期 目的別売上高

売上高の推移



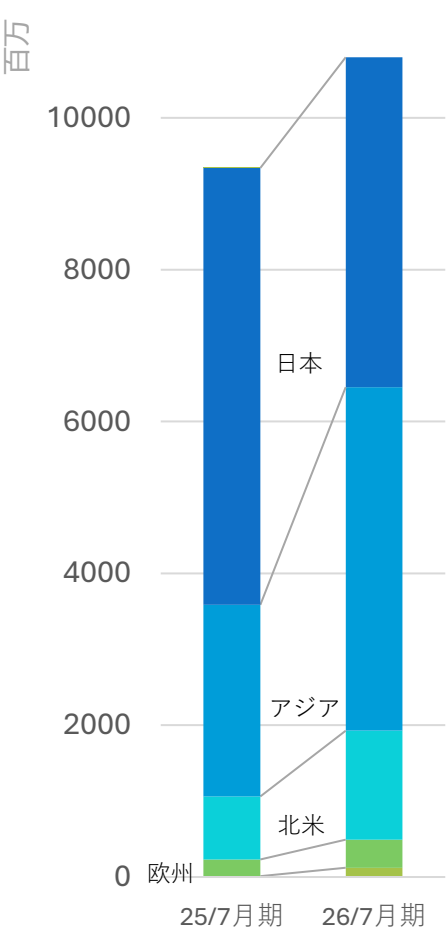
構成比の推移



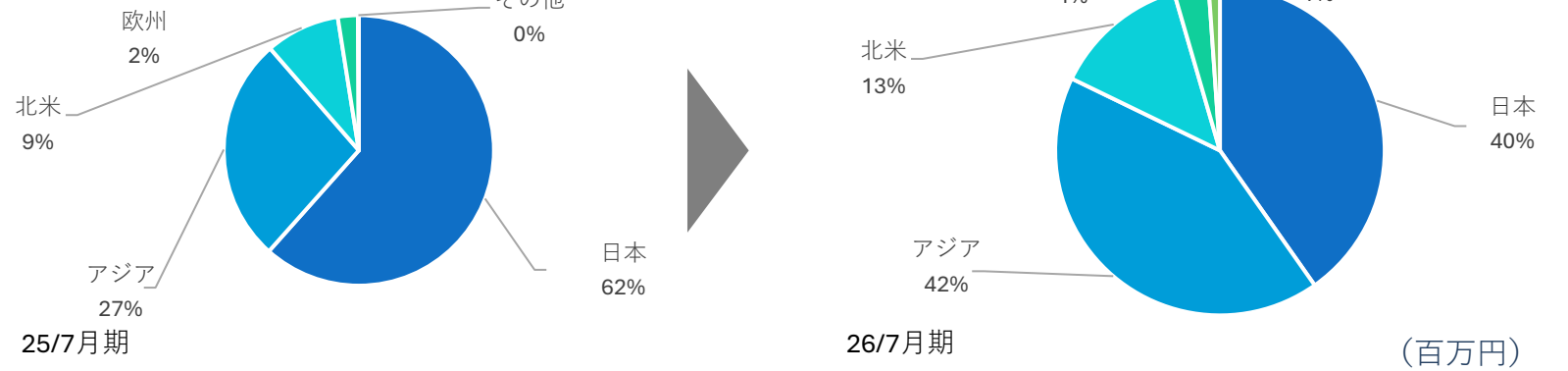
25/7月期			26/7月期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	前年同期比
研究開発用	4,415	47.3%	3,588	33.2%	△18.7%
生産用	3,572	38.2%	5,688	52.7%	+59.2%
部品・メンテナンス	1,354	14.5%	1,523	14.1%	+12.5%
合計	9,342	100.0%	10,800	100.0%	+15.6%

26/7月期 地域別売上高

売上高の推移

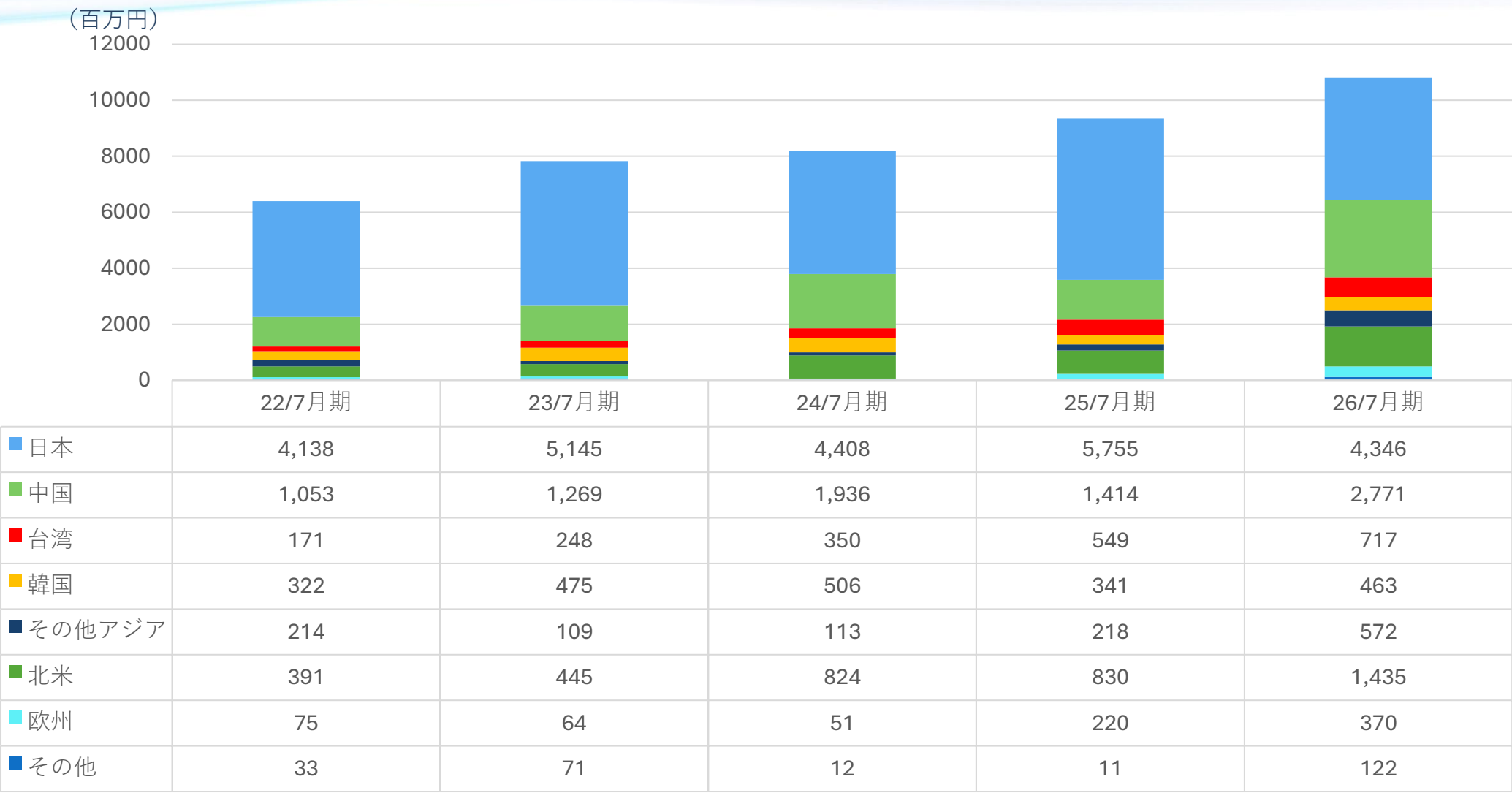


構成比の推移

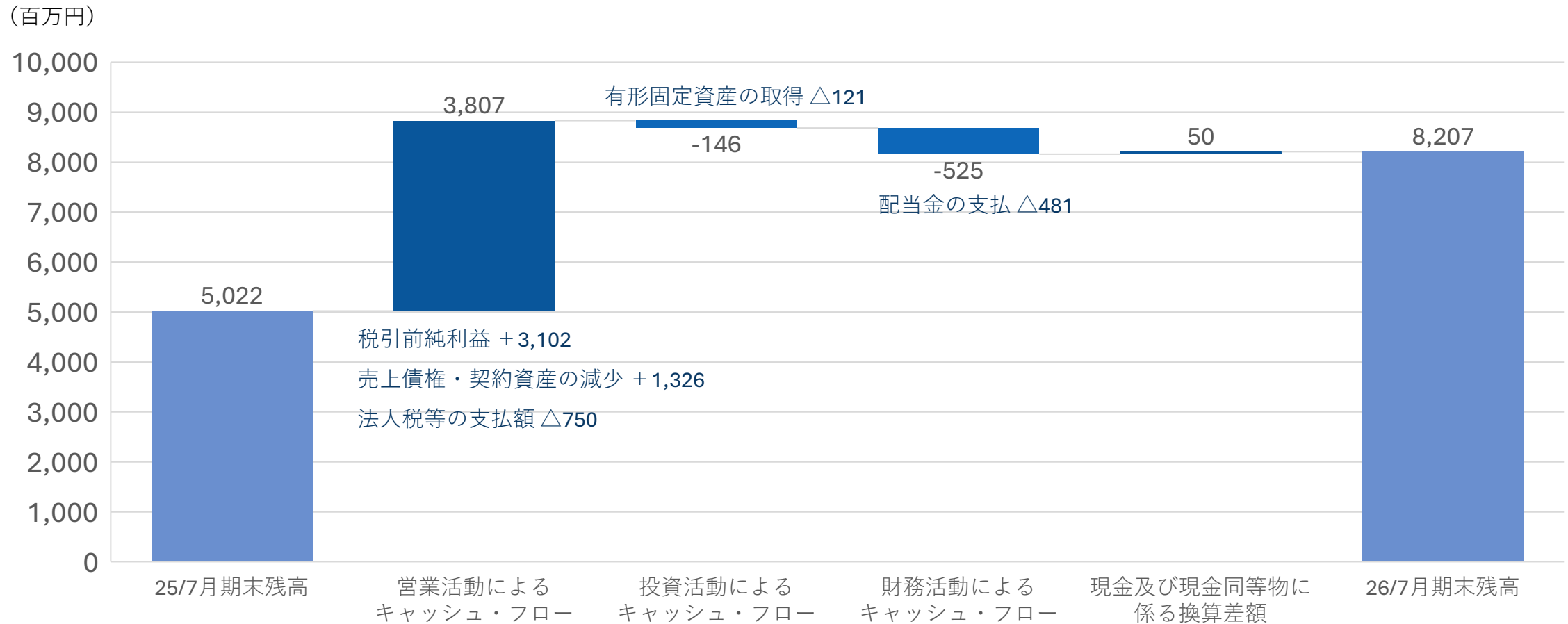


	25/7月期		26/7月期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	前年同期比
日本	5,755	61.6%	4,346	40.2%	△24.5%
アジア	2,524	27.0%	4,525	41.9%	+79.3%
北米	830	8.9%	1,435	13.3%	+72.8%
欧州	220	2.4%	370	3.4%	+68.3%
その他	11	0.1%	122	1.1%	+1010.3%
海外合計	3,586	38.4%	6,454	59.8%	+80.0%
合計	9,342	100.0%	10,800	100.0%	+15.6%

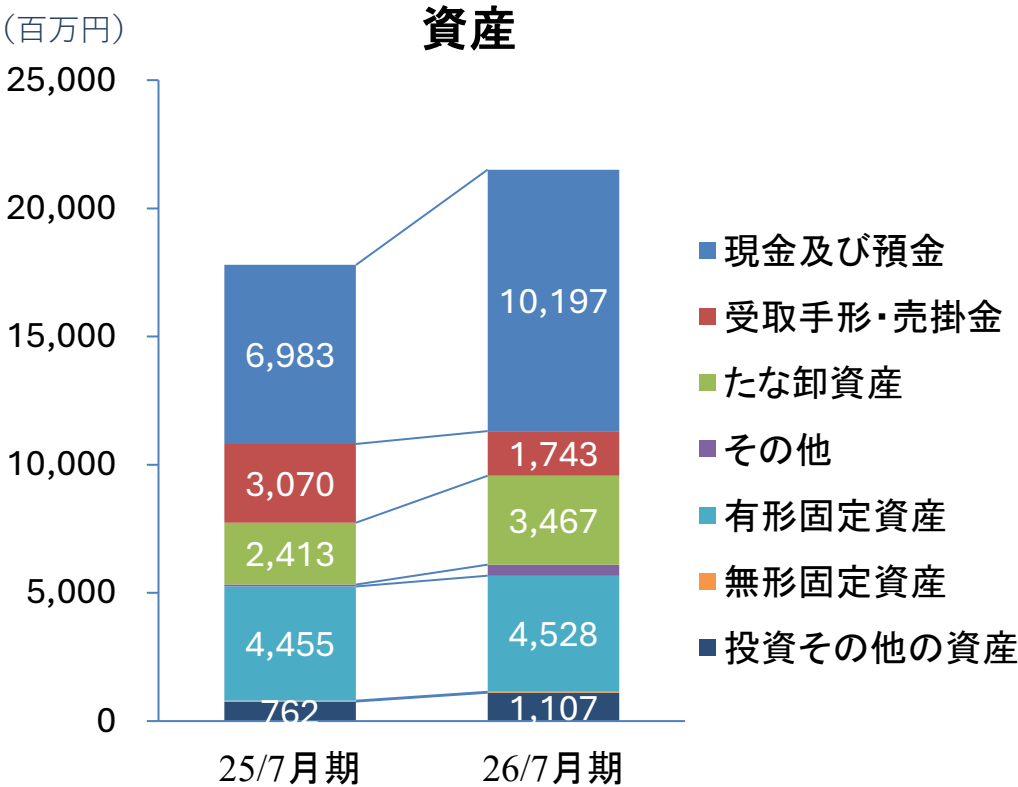
過去5期 地域別売上高



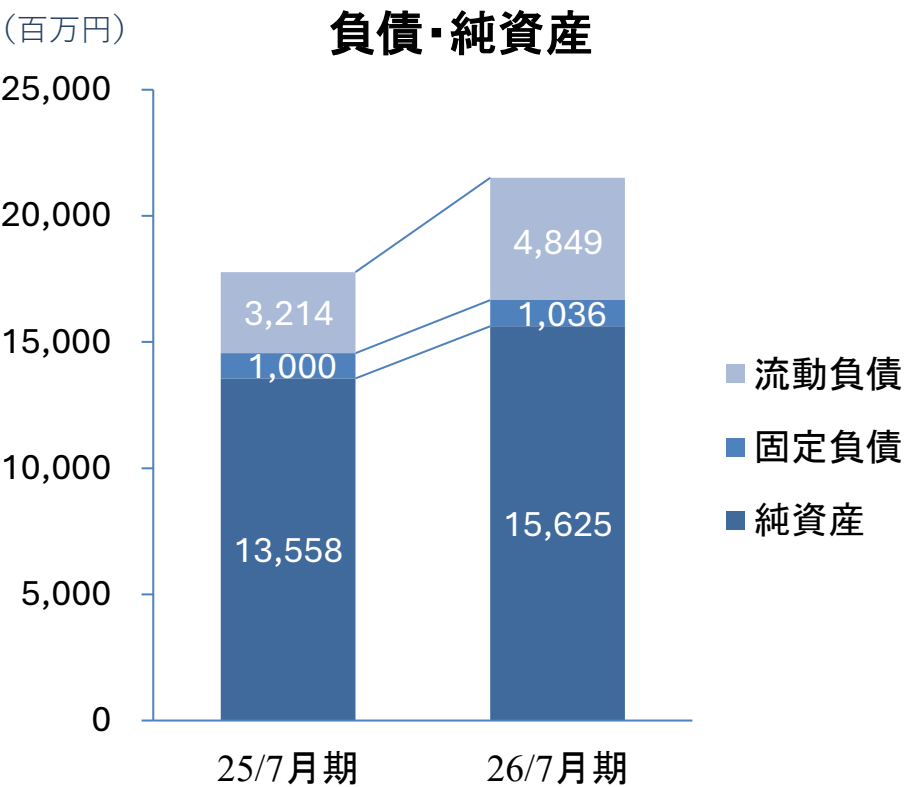
26/7月期 キャッシュ・フロー



貸借対照表（前事業年度末比）



- ・ 現金及び預金 3,214百万円増
- ・ 受取手形・売掛金 1,327百万円減
- ・ 建設仮勘定 601百万円減
- ・ 有形固定資産 73百万円増



- ・ 買掛金 316百万円増
- ・ 契約負債 1,107百万円増
- ・ 繰越利益剰余金 1,748百万円増

目次

1. 2026年7月期 決算概要
2. 2027年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料



ALE装置（原子層エッチング装置）
「RIE-400iP」

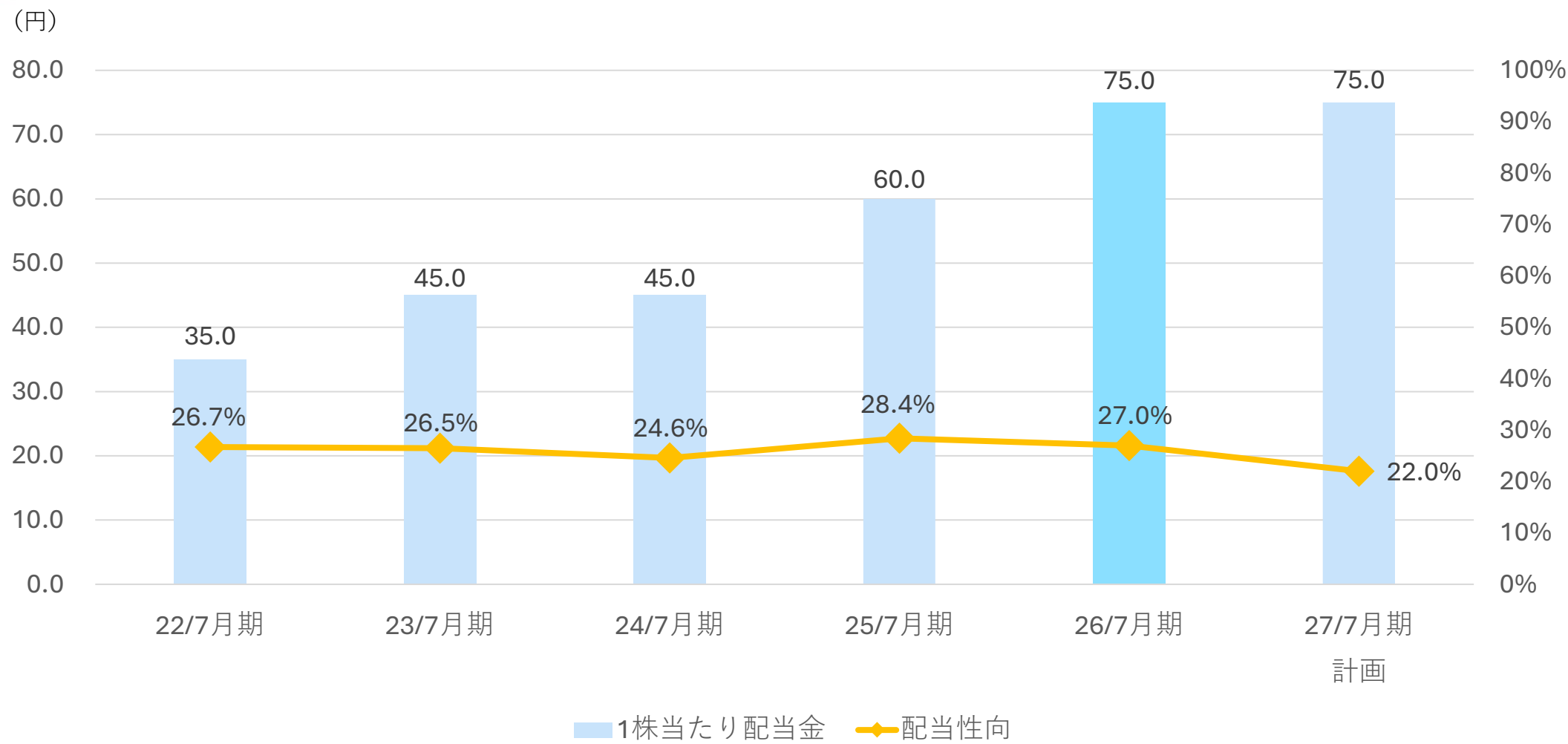
2反応室ALD装置（原子層堆積装置）
「AD-8002LPC」

27/7月期 業績予想

(百万円)

	26/7月期	27/7月期			前年同期比
		上期予想	下期予想	通期予想	
売上高	10,800	7,000	7,500	14,500	+34.3%
売上総利益	5,535	3,490	3,780	7,270	+31.3%
売上高総利益率	51.3%	49.9%	50.4%	50.1%	-
営業利益	3,004	1,810	2,070	3,880	+29.1%
営業利益率	27.8%	25.9%	27.6%	27.4%	-
経常利益	3,110	1,780	2,060	3,840	+23.5%
当期純利益	2,230	1,180	1,560	2,740	+22.9%

1株当たり配当金と配当性向の推移



目次

1. 2026年7月期 決算概要
2. 2027年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料



ALE装置（原子層エッチング装置）
「RIE-400iP」

2反応室ALD装置（原子層堆積装置）
「AD-8002LPC」

Topics

InPデバイス加工・成膜装置ラインナップを拡充 ー 研究開発用途から生産需要の取り込みへ ー

AIデータセンター需要の拡大を背景に、InPデバイス向け装置を拡充

- 3・4・6インチ基板に対応するICP、CCP-RIE、PECVD等のラインナップを強化し、光通信・光電融合分野の幅広いプロセスに対応。
- 研究開発装置で培った技術・実績を基盤に、量産・生産用途の需要取り込みを加速するとともに、GaAs・GaN高周波デバイス、GaN・SiCパワーデバイスへの展開を推進します。

① 市場拡大

AIデータセンター投資の拡大により、光通信デバイス需要が増加

② 対応領域拡大

3・4・6インチ対応 × ICP・CCP-RIE・PECVD等のラインナップ拡充

③ 成長フェーズへ

研究開発用途での実績を基盤に、**生産需要の取り込みを加速**
光通信からGaAs・GaN高周波、GaN・SiCパワーデバイスへ展開

Precision **ICP** Etching for
ø6" InP Laser Diode

ø3", 4", and 6" Wafer Process Systems
ICP · CCP · PECVD · ALD · UV-O₃



ICP Etching System
RIE-600iPNC

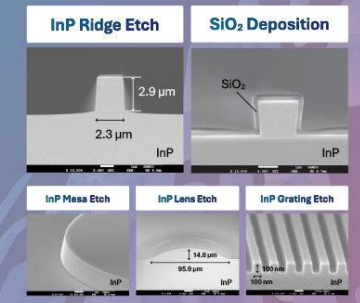
CCP-RIE System
RIE-2001LC

PECVD System
PD-2201HLC

2 RCLs ALD System
AD-8002LPC

UV Ozone Cleaning System
UV-300HC

InP
Plasma Etch & CVD Solutions



原子層レベルの制御を実現するALE装置の販売を開始

当社は、原子層レベルでの精密なエッチング制御を可能にするALE装置「RIE-400iP-ALE」および「RIE-800iPC-ALE」の販売を開始いたしました。本製品は本格的な販売開始に先立ち、既に国内外の大学・研究機関様への販売・納入実績があり、次世代デバイス開発における重要プロセスとし高い関心と評価をいただいております。

○成長市場への展開

光通信・光電融合

シリコンフォトリソ、光導波路

量子コンピューター

超伝導量子ビット、スピン量子ビット

ウェアラブル・
フレキシブル
センサー、共振器

パワーデバイス

GaN HEMT、SiC MOSFET

ヘルスケア・ バイオ

バイオセンサー、ナノポア

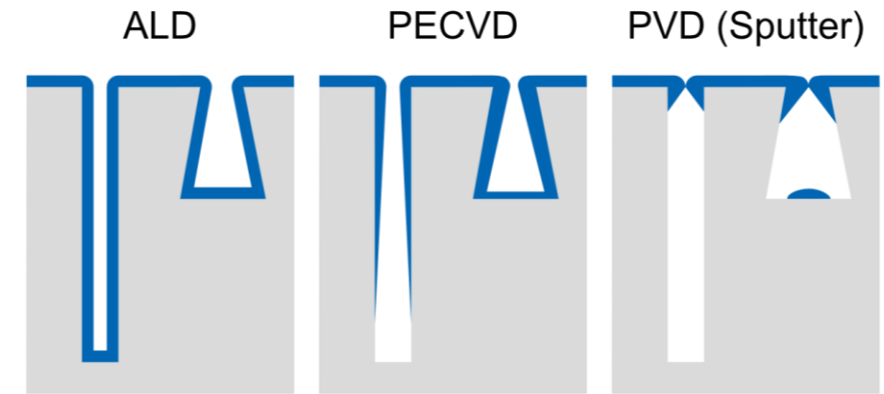
先端パッケージ

3D積層、ハイブリッドボンディング

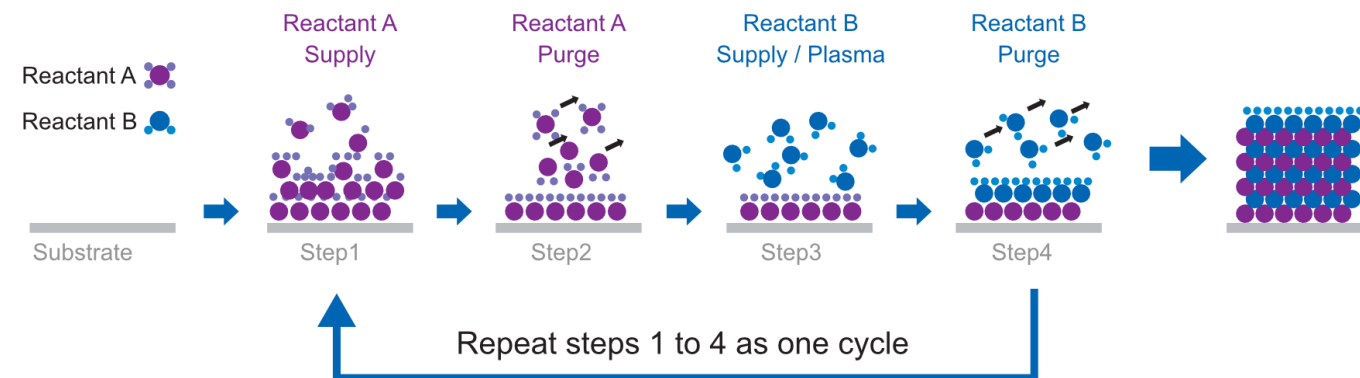


去る2月16日、北海道大学 電子科学研究所 教授の松尾先生をお招きし、「ALDの最近の話題」と題した講演会を開催しました。

講演では、ALDの最新研究動向やデバイス応用、材料開発、市場動向についてご紹介いただきました。また、今後の市場成長の見通しに加え、エリア選択ALD、窒化膜対応、成膜高速化などの技術課題についても議論が行われ、当社技術者にとって貴重な学びの機会となりました。



Coverage of various deposition methods



国際学会・産学連携イベントでALE技術を発信

当社は、米国開催の「ALD/ALE 2026」および「OneNano Meeting」において、ALE（Atomic Layer Etching）技術に関する研究成果・技術講演を実施しました。

ALD/ALE 2026では、 SiO_2 準ALEプロセスのエッチングレート安定化に関する研究成果を発表しました。OneNano Meetingでは、半導体材料向けプラズマエッチング技術に関する講演を行い、研究者・技術者との活発な技術交流を実施しました。両イベントを通じて、当社の先端エッチング技術の認知向上と、グローバルな研究機関・顧客との関係強化を推進しました。今後も次世代半導体製造を支えるプロセス技術の研究開発と事業機会の創出に取り組んでまいります。



生産キャパシティ向上の取り組み

当社はファブライト型生産を採用しており、製造・組立・電気配線などの工程は信頼できる外部協力会社へ委託しております。

今後の需要拡大を見据え、生産キャパシティを段階的に拡大しております。

組立

外部パートナーの活用により、最大で現状の約2倍まで対応可能

調整・検査

能力増強を継続中

- ・ 中小型機：約50%増強済み
- ・ 大中型機：約50%の増強に着手



外部協力会社の工場外観・生産スペース

台湾ITRI（工業技術研究院）を訪問、連携強化に向け意見交換

去る2026年2月2日、当社代表取締役会長の辻 理が、台湾・新竹県の工業技術研究院（ITRI）を訪問し、今後の連携強化に向けた意見交換を行いました。

ITRIは台湾を代表する研究機関であり、世界有数の応用技術研究機関として6,500人超の研究開発人材を擁する研究開発拠点です。TSMCおよびUMCの創出に貢献するなど、台湾半導体産業の発展を牽引してきました。また、先端技術の事業化を推進し、台湾の産業競争力向上に重要な役割を果たしています。



左から：サムコ株式会社 代表取締役会長 辻 理、ITRI 院長 張 培仁氏、ITRI 副院長 胡 竹生氏

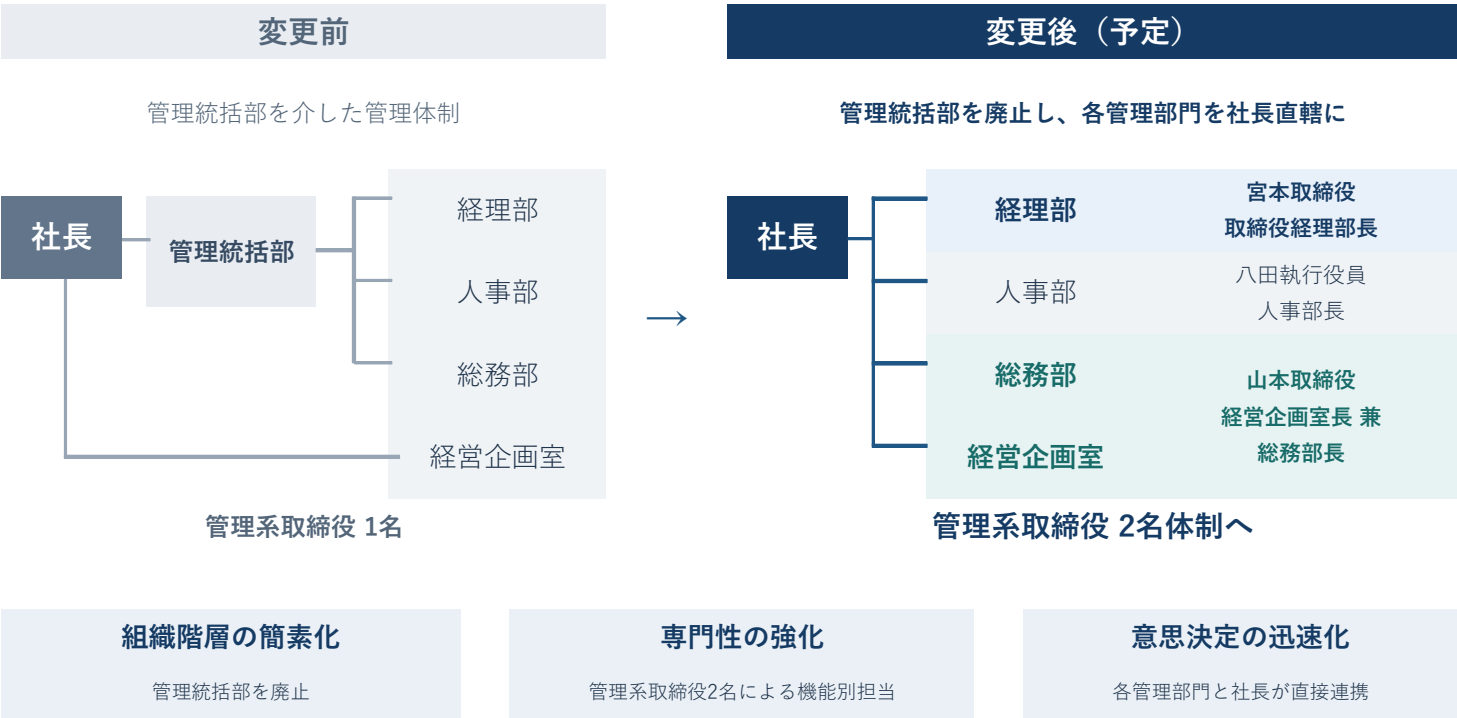
Topics

管理部門の組織体制を再編

事業規模の拡大に対応し、経営管理体制の強化と意思決定の迅速化を図るため、管理統括部を廃止しました。

あわせて、管理部門を担当する取締役を2名体制とし、宮本取締役が経理部、山本取締役が経営企画室・総務部を担当します。

組織階層を簡素化するとともに、それぞれの専門性を活かした役割分担を明確にすることで、事業成長を支える経営管理機能のさらなる強化を図ります。



米国バージニア・コモンウェルス大学EMBA生 サムコを訪問

当社は、VCU EMBAグローバルチャレンジプログラムの一環として、バージニア・コモンウェルス大学（VCU）のEMBA学生および教職員25名を京都本社に迎えました。

訪問では、当社の創業から現在に至るまでの歩みや、半導体産業における当社技術の役割について紹介しました。

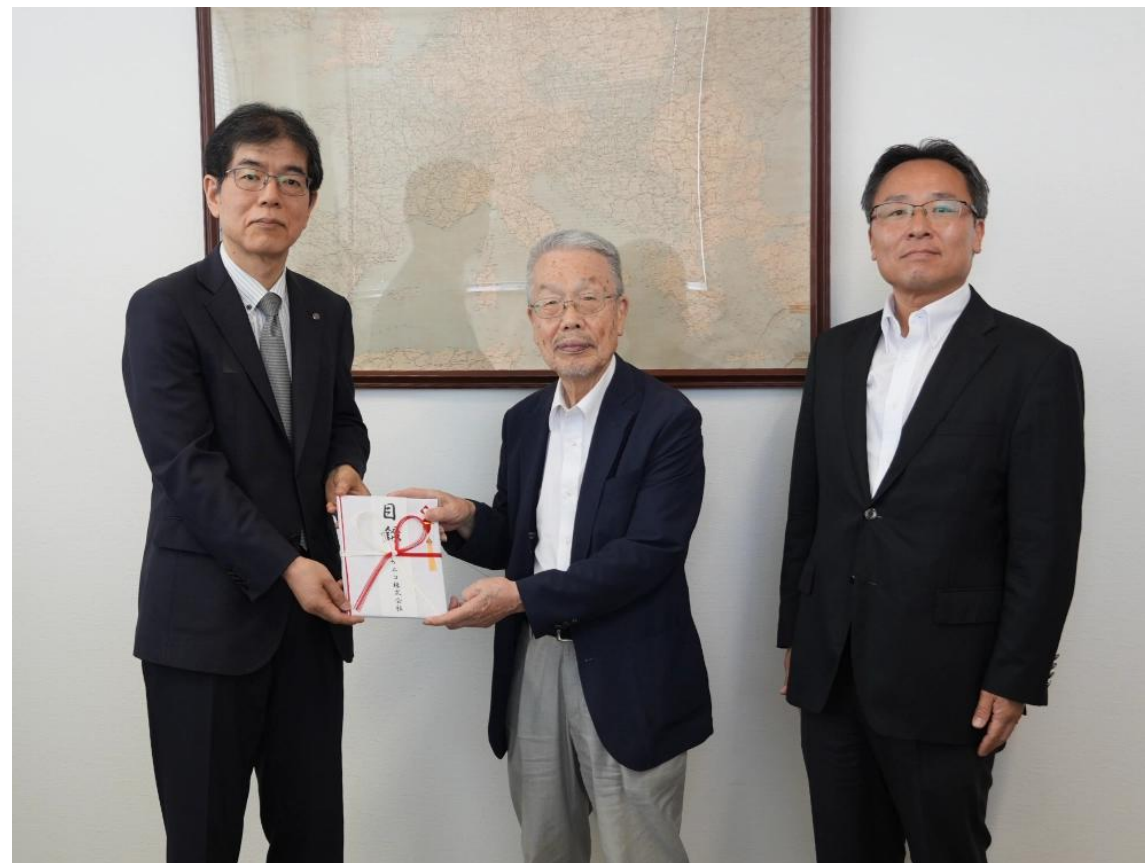
活発な質疑応答も行われ、本訪問は当社の事業や技術、日本企業の価値観への理解を深めるとともに、グローバル人材との交流を深める貴重な機会となりました。



2026年ベネズエラ地震救援金への寄付

当社は、社会貢献活動の一環として、毎年決算期である7月に日本赤十字社への寄付を行っています。

このたび、2026年6月にベネズエラで発生した地震により被災された方々への支援として、日本赤十字社の「2026年ベネズエラ地震救援金」に1,000万円を寄付いたしました。被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げるとともに、被災地域の日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。



目次

1. 2026年7月期 決算概要
2. 2027年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料



ALE装置（原子層エッチング装置）
「RIE-400iP」

2反応室ALD装置（原子層堆積装置）
「AD-8002LPC」

新取締役会体制（2026年10月27日予定）

代表取締役会長	辻	理	常勤監査役	辻村	茂
代表取締役社長	川邊	史	社外監査役	木村	学
取締役専務執行役員	山下	晴彦	社外監査役	羽津	隆弘（新任）
取締役執行役員	宮本	省三			
取締役執行役員	佐藤	清志			
取締役執行役員	山本	仁志（新任）			
社外取締役	高須	秀視			
社外取締役	藤田	静雄			
社外取締役	柳本	依子			

中期経営計画 重要指標（見直し後）

装置製造原価率

46 % 以下

営業利益率

25 % 以上

海外売上比率

50 % 以上

	第47期（実績）	第48期（計画）	第49期（計画）
売上高 （前年同期比）	108.0億円 （+15.6%）	145.0億円 （+34.3%）	180.0億円 （+24.1%）
装置製造原価率	44.3%	46.6%	46.0%
営業利益 （営業利益率）	30.0億円 （27.8%）	38.7億円 （26.8%）	48.8億円 （27.2%）
海外売上高 （海外売上比率）	64.5億円 （59.8%）	87.0億円 （60.0%）	108.0億円 （60.0%）
国内売上高	43.4億円	58.0億円	72.0億円

中期経営計画目標を上方修正

	第47期（実績）	第48期（修正前）	第48期（修正後）	第49期（修正前）	第49期（修正後）
売上高 （前年同期比）	108.0億円 （+15.6%）	112.0億円 （+3.7%）	145.0億円 （+34.3%）	123.0億円 （+9.8%）	180.0億円 （+24.1%）
装置製造原価率	44.3%		46.6%	46.0%	46.0%
営業利益 （営業利益率）	30.0億円 （27.8%）		38.7億円 （26.8%）	31.4億円 （25.6%）	48.8億円 （27.2%）
海外売上高 （海外売上比率）	64.5億円 （59.8%）		87.0億円 （60.0%）	61.5億円 （50.0%）	108.0億円 （60.0%）
国内売上高	43.4億円		58.0億円	61.5億円	72.0億円

中計の重要課題とその進捗

重点施策			進捗状況
1	新しいプロセス及び新規装置の開発、販売	 順調に進展	- ALE装置の販売を開始 - InP加工用生産装置ラインナップ拡充
2	生産機販売の強化	 順調に進展	- 生産機販売構成比 56.7%、前期比+59%。 - 部品、メンテナンス専属部署設立
3	海外販売の拡大	 順調に進展	- 海外売上65.5億円（前期比+80%） - 海外売上比率60%
4	生産体制の拡充	 順調に進展	- 生産キャパ200億円に目処 - 生産平準化進展
5	更なる成長に向けた人員育成・活躍推進	 予定通り	- 社員教育 - 高度人材の採用
6	サステナビリティへの取り組み	 予定通り	- 装置のCO₂排出量抑制 - 社会貢献

サムコを取り巻く環境

最先端技術で、未来の当たり前を創る

1. 光電融合・ 光デバイス

シリコンフォトリソグラフィ : CAGR 29.5%



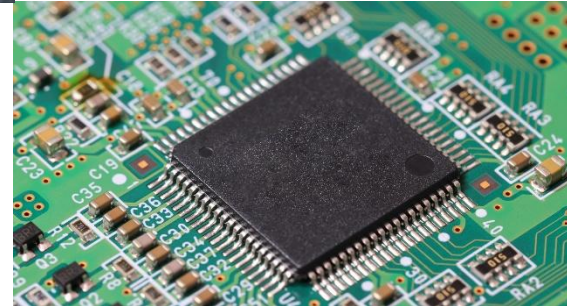
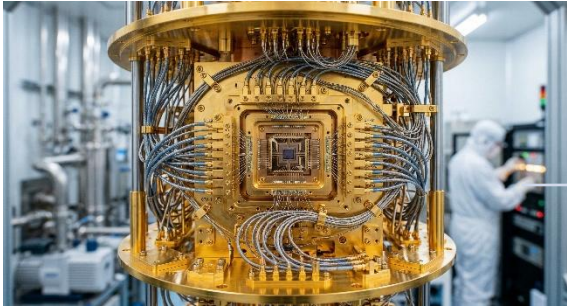
4. 電子部品 (高周波フィルタ・MEMS)

MEMS : CAGR 4.6%



2. 量子デバイス・ 2次元材料

量子コンピューター : CAGR 41.8%



5. 先端パッケージング

先端パッケージング : CAGR 9.4%

3. 次世代 パワーデバイス

パワーデバイス : CAGR 5.4%



6. ライフサイエンス・ ヘルスケア

ヘルスケア関連 : CAGR 4.6%



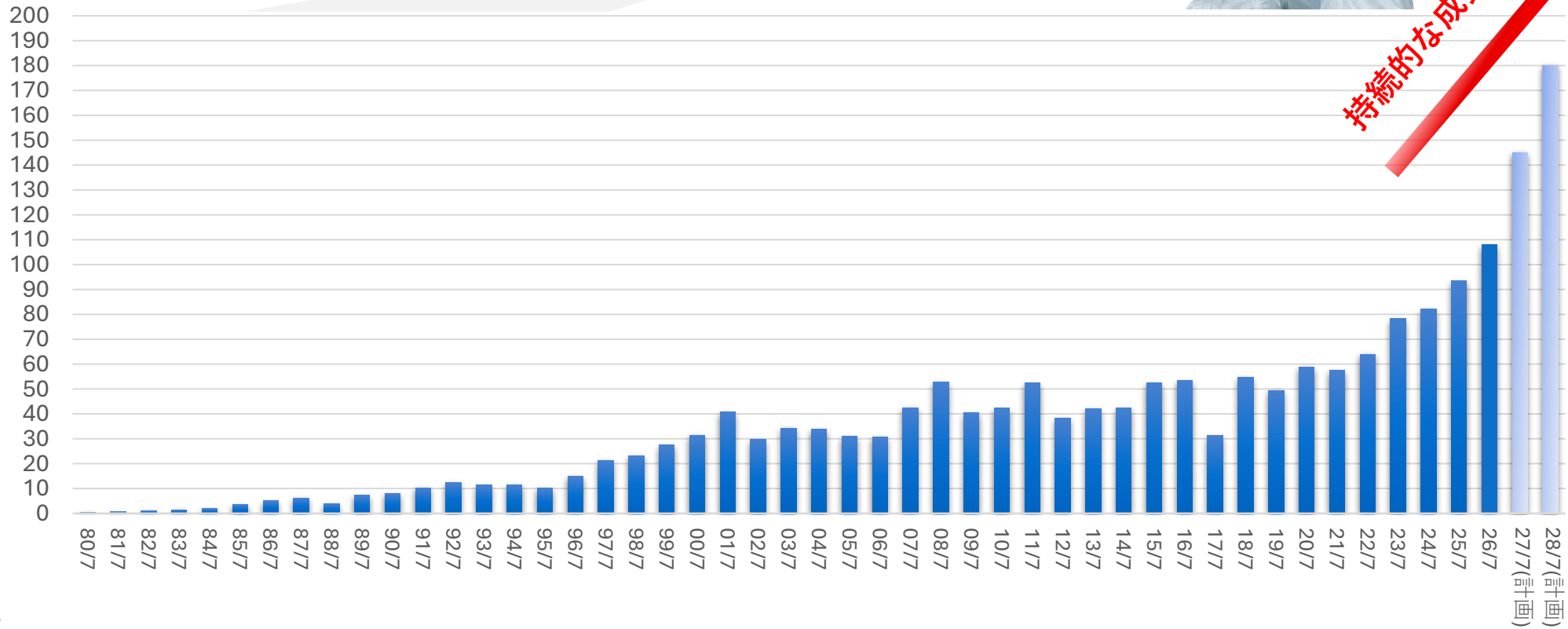
中期経営計画 — そしてその先へ、

「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。」の理念のもと
右肩上がりの成長を実現



持続的な成長へ

売上高
(億円)



お問い合わせ

サムコ 株式会社

経営企画室

E-mail: kikaku@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



A Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology

目次

1. 2026年7月期 決算概要
2. 2027年7月期 業績予想
3. Topics
4. 中期経営計画
5. 参考資料



ALE装置（原子層エッチング装置）
「RIE-400iP」

2反応室ALD装置（原子層堆積装置）
「AD-8002LPC」

参考資料

会社概要

商 号	サムコ株式会社 Samco Inc.
代 表 者	代表取締役会長 辻 理（つじ おさむ） 代表取締役社長 川邊 史（かわべ つかさ）
設 立	1979年（昭和54年）9月1日
本 社 所 在 地	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36
事 業 内 容	半導体等電子部品製造装置の製造及び販売
売 上 高	108.0億（2026年7月期）
従 業 員	201名（2026年7月）
証 券 コ ー ド	6387 東京証券取引所 プライム市場



代表取締役会長
辻 理

代表取締役社長
川邊 史

1980

半導体プロセス用大型CVD装置の開発、販売を開始

1981

化合物半導体製造用MOCVD装置の開発、販売を開始

国産初

1979

サムコインターナショナル研究所 設立



1984

東京都品川区に東京出張所（現東日本営業部）を開設

1987

米国カリフォルニア州にオプトフィルムス研究所を開設

沿革

液体ソースによる高速成膜用CVD装置の開発、販売を開始

1990

1995

小型、汎用プラズマエッチング装置RIE-10NR
の開発、販売を開始

700+
の販売実績



1997

キンビール株式会社と共同で、
プラスチックボトルにDLC膜を形成する技術を開発

2001

日本証券業協会に株式を店頭上場

2004

株式会社サムコインターナショナル研究所から
サムコ 株式会社へ社名を変更

2013

東京証券取引所市場第二部へ上場市場を変更

2014

東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

2015

原子層堆積（ALD）装置AL-1の開発・販売を開始

2016

Aqua Plasma®洗浄装置AQ-2000の開発、販売を開始

2021

クラスターツールシステム「クラスターH™」の販売を開始



2026

生産用ALD装置「AD-8002LPC」の販売を開始

2022

プライム市場へ移行

2025

先端技術研究棟を竣工

先端
技術研究棟
竣工





deposition



etching



surface
treatment

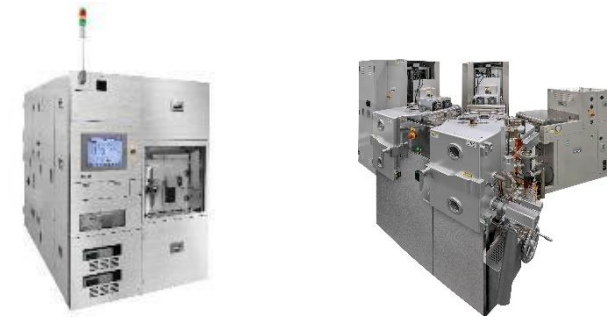
■ 薄膜形成分野

- プラズマCVD装置
- 液体ソースCVD®装置
- ALD (Atomic Layer Deposition) 装置



■ 微細加工分野

- 反応性イオンエッチング装置
- ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- ALE (Atomic Layer Etching) 装置
- 高速Siディープエッチング装置
- XeF₂ドライエッチング装置

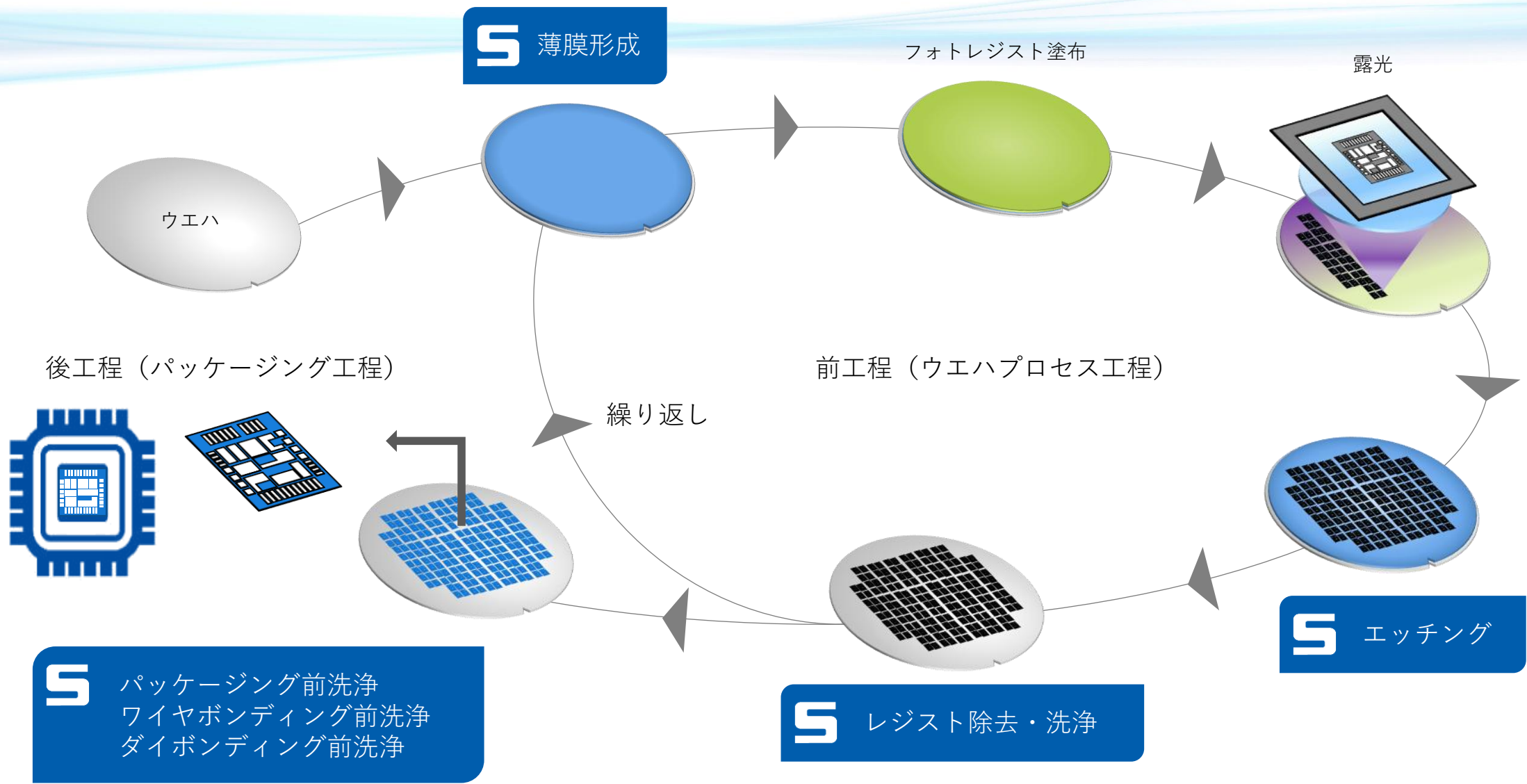


■ 洗浄・表面処理分野

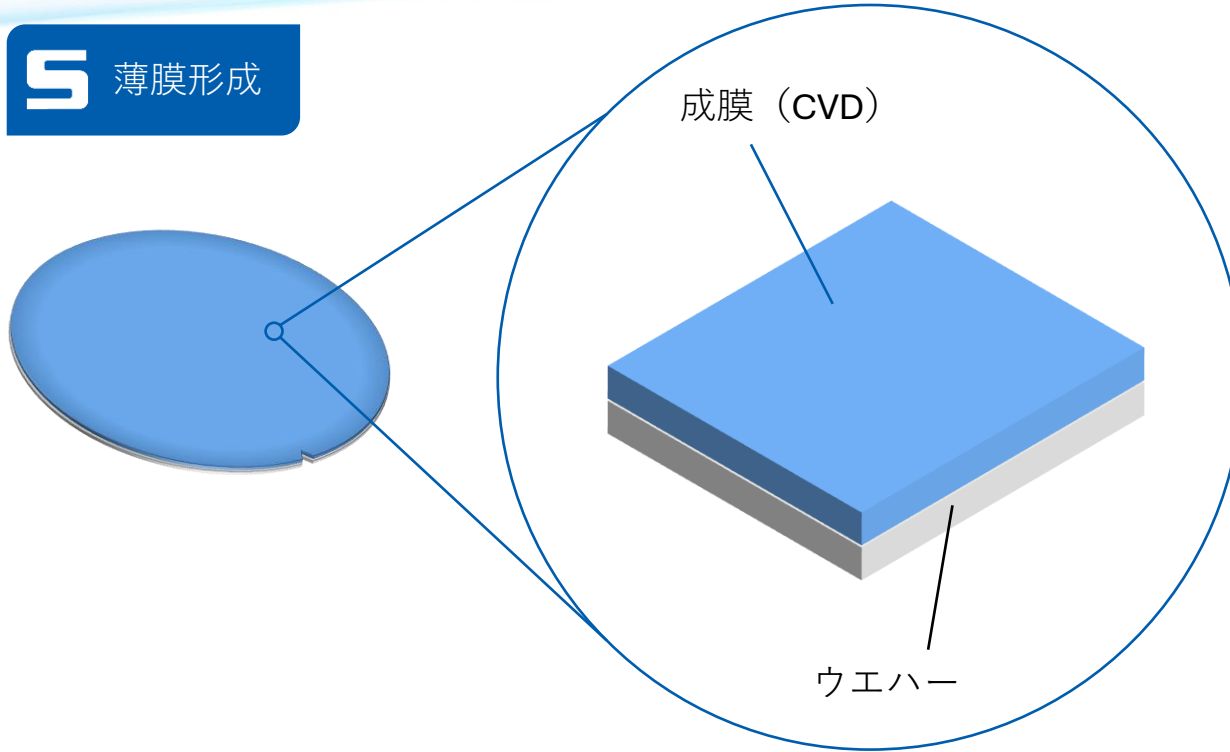
- Aqua Plasma® クリーナー
- プラズマクリーナー
- UVオゾンクリーナー



半導体製造工程概略 サムコの使われる工程



S 薄膜形成



薄膜形成分野では、**CVD**（Chemical Vapor Deposition: 化学気相成長）装置を提供しています。**CVD**とは、原料となるガスを化学反応させ、半導体の表面に非常に薄い膜（数nm～数μmの厚み）を形成する技術です。

サムコの**CVD**装置は、プラズマのエネルギーを利用して化学反応を促進することで、比較的低温でも高品質な薄膜を形成することができます。また、微細で複雑な構造を持つ半導体の表面にも均一な膜を形成できるため、先端半導体の製造工程で幅広く活用されています。

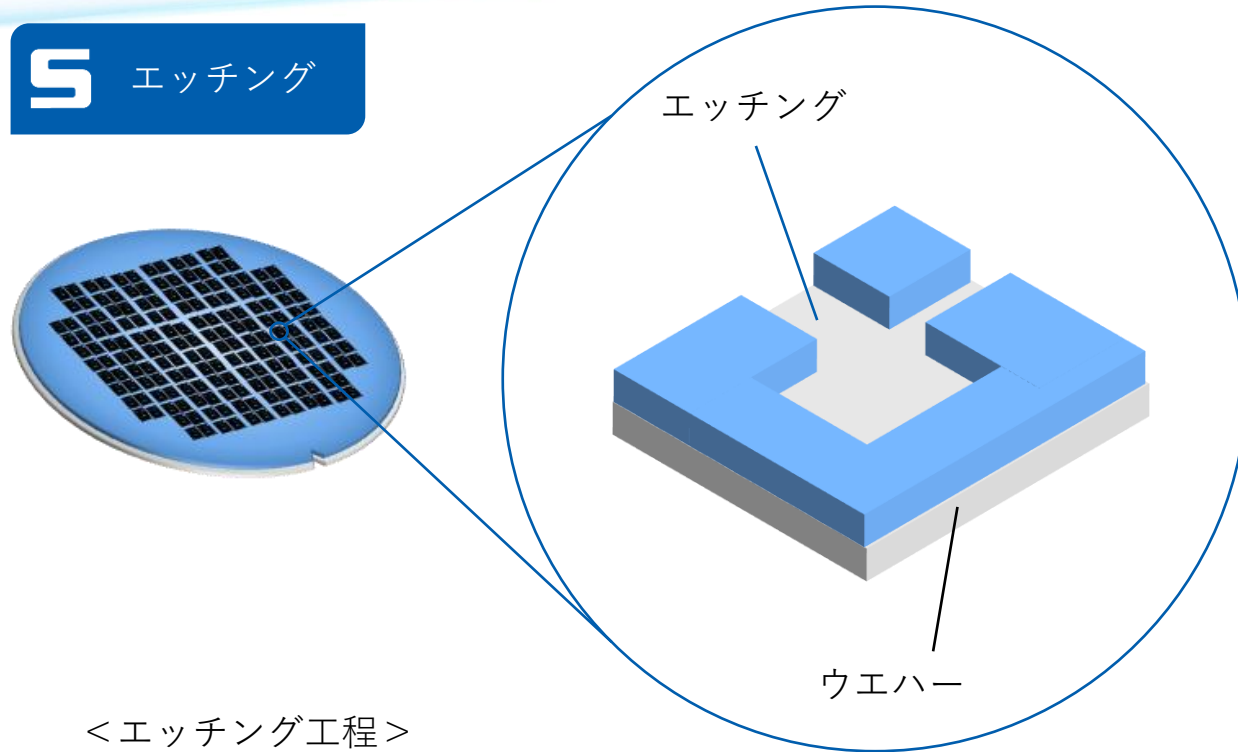
形成された薄膜は、半導体を水分や汚染物質から保護するほか、電気を通さない絶縁性や光学的な特性を持たせるなど、デバイスの性能や信頼性を支える重要な役割を担っています。

薄膜の品質は半導体の性能に影響するため、高精度な成膜技術が求められています。

< 成膜工程 >



S エッチング

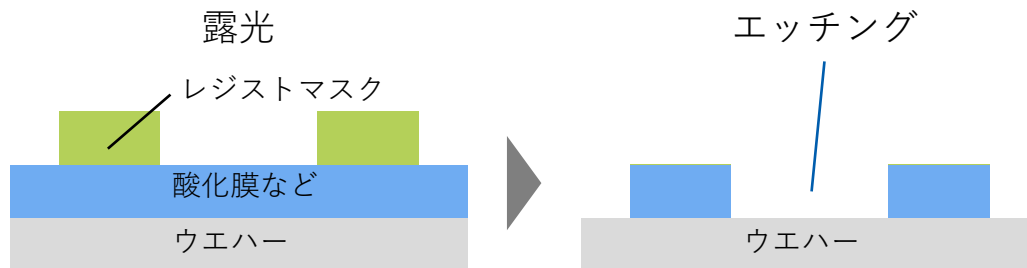


微細加工分野では、ドライエッチング装置を提供しています。ドライエッチングとは、プラズマを利用して半導体表面の不要な部分を削り取り、微細な回路や構造を形成する技術です。半導体の高性能化や小型化を実現するうえで欠かせない重要な工程の一つです。

サムコのドライエッチング装置は、プラズマを高精度に制御することで、ナノメートルレベルの微細な加工を可能にします。また、複雑な形状や深い溝にも高精度な加工を行うことができるため、先端半導体の製造工程で幅広く活用されています。

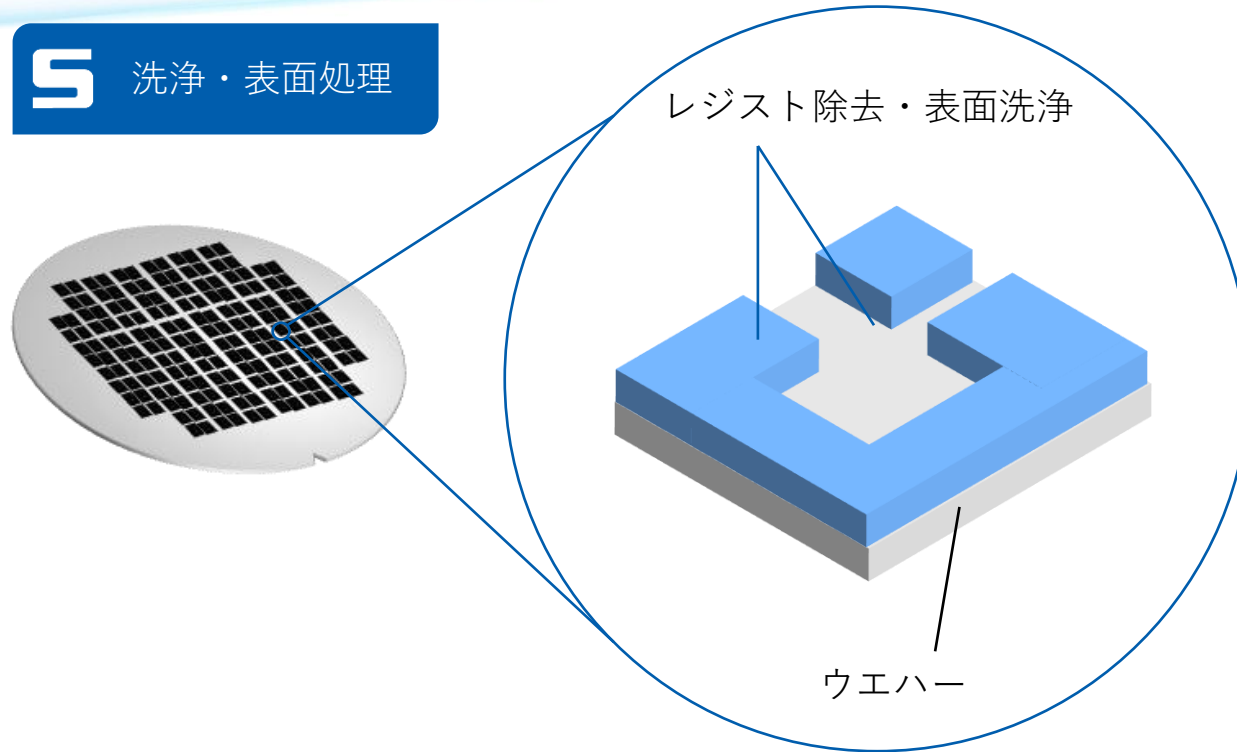
形成された微細構造は、電気信号の制御やデバイス性能の向上に重要な役割を担っています。加工精度は半導体の性能や信頼性に影響するため、高精度なエッチング技術が求められています。

<エッチング工程>



レジストマスクに覆われていない
不要な薄膜を削り取る

S 洗浄・表面処理



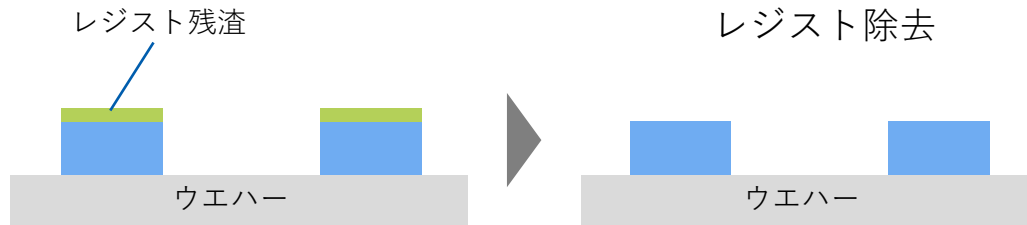
洗浄・表面処理分野では、プラズマ洗浄装置およびUVオゾンクリーナーを提供しています。

プラズマ洗浄とは、半導体表面に付着した微細な汚染物質や有機物を除去し、クリーンな状態を実現する技術です。また、表面処理では、材料表面の状態を改質することで、その後の成膜や接合工程の品質向上に貢献します。

サムコの装置は、プラズマを高精度に制御することで、材料へのダメージを抑えながら効率的な洗浄・表面処理を実現します。微細化が進む半導体デバイスにも対応し、高い再現性と安定した処理品質を提供しています。

洗浄や表面処理は、半導体製造工程において品質や歩留まりを左右する重要な工程です。わずかな汚染物質や表面状態の違いがデバイス性能に影響するため、高精度な洗浄・表面処理技術が求められています。

<レジスト除去・洗浄工程>



最先端技術で、未来の当たり前を創る

1. 光電融合・ 光デバイス

データ社会の限界を突破する



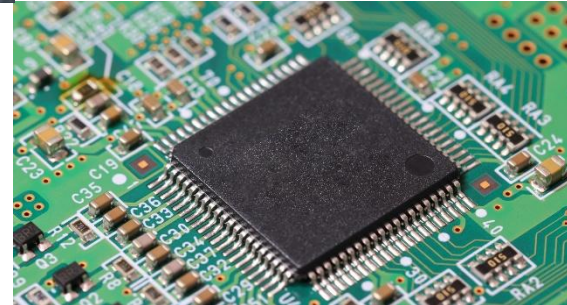
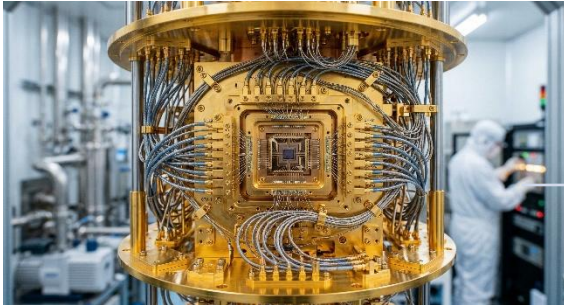
4. 電子部品 (高周波フィルタ・MEMS)

つながる日常を、より高度に



2. 量子デバイス・ 2次元材料

物理の限界に挑むナノ制御



5. 先端パッケージング

半導体の真価を引き出す実装技術

3. 次世代 パワーデバイス

クリーンなエネルギー循環を支える



6. ライフサイエンス・ ヘルスケア

テクノロジーで、健やかな暮らしへ



1. 光電融合・ 光デバイス

データ社会の限界を突破する

AIコンピューティングとデータセンターの電力課題を解決する「光電融合」。

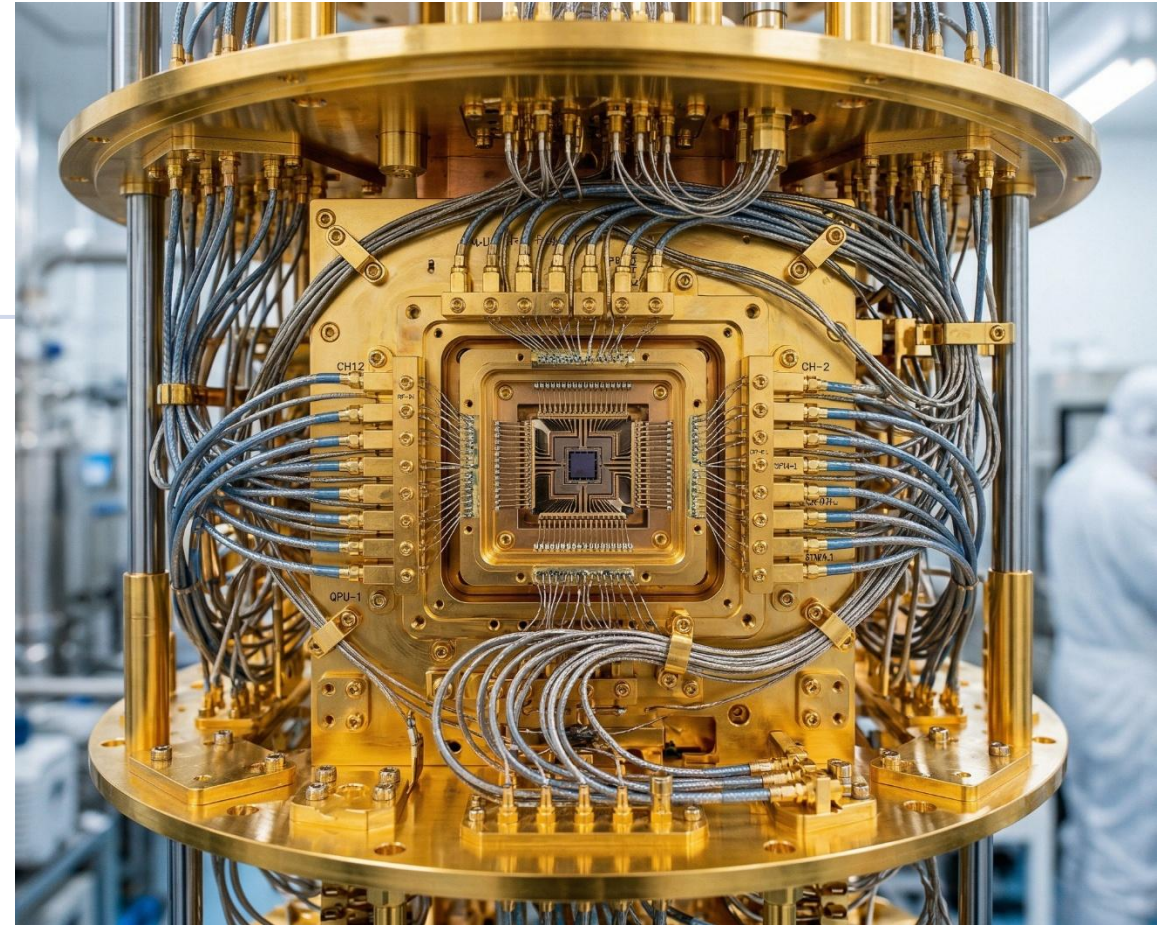
私たちは、InP（リン化インジウム）やGaAs（ヒ化ガリウム）を用いた端面発光レーザー（EEL）や面発光レーザー（VCSEL）といった光デバイス製造において、長年培った知見を提供し、次世代ネットワークの高速化・低消費電力化を加速させています。



2. 量子デバイス・ 2次元材料

物理の限界に挑むナノ制御

量子コンピュータの実現に向けた超伝導量子ビットや、グラフェンをはじめとする2次元材料。ナノレベルでの制御性が求められるこれらの領域に、ALD（原子層堆積）やALE（原子層エッチング）などの先端技術で応え、未知の可能性を秘めたデバイス開発を支えます。



3. 次世代 パワーデバイス

クリーンなエネルギー循環を支える

脱炭素社会の実現に向け、電気自動車（EV）や再生可能エネルギーの効率を高める次世代パワーデバイス。 GaN （窒化ガリウム）や SiC （炭化ケイ素）に加え、 Ga_2O_3 （酸化ガリウム）やダイヤモンドなどの次世代材料に対応するALD（原子層堆積）やALE（原子層エッチング）技術を通じて、エネルギーの未来を切り拓きます。



4. 電子部品 (高周波フィルタ・MEMS)

つながる日常を、より高度に

スマートフォンに欠かせない高周波フィルタ（BAW/SAW）やスマート社会の「目」となるMEMSセンサー。圧電材料の高精度エッチングやBosch Processによる高速シリコンディープエッチング技術により、デバイスの小型化と高性能化を両立させ、より便利で安全な社会づくりに貢献しています。

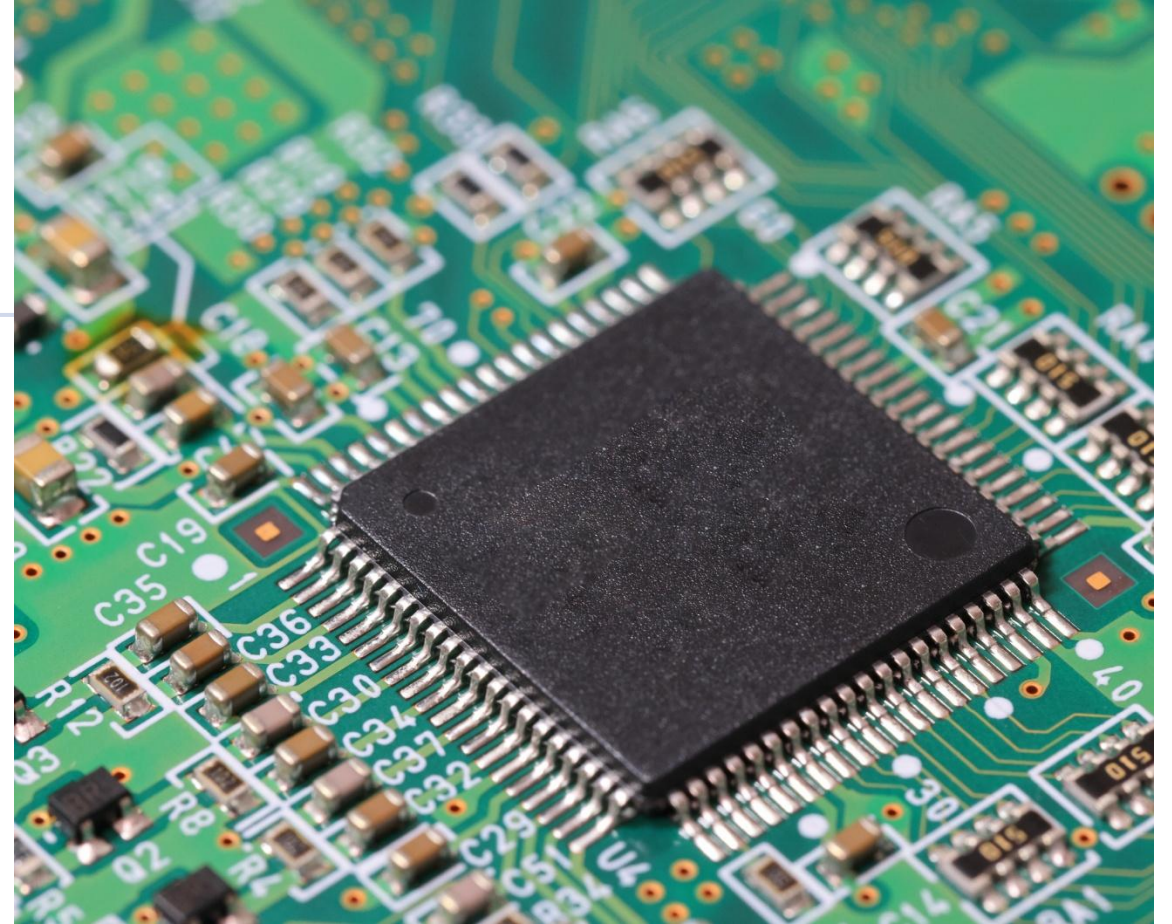


5. 先端パッケージング

半導体の真価を引き出す実装技術

チップレット構造や3D実装など、半導体のさらなる進化を支える後工程。

Aqua Plasma® による還元性プラズマ処理やウエハ接合前の表面改質、 Bosch Processによる高速シリコンディープエッチングなどを通じて、複雑化するパッケージングプロセスにおける歩留まりと信頼性の向上に貢献します。



6. ライフサイエンス・ヘルスケア

テクノロジーで、健やかな暮らしへ

独自のAqua Plasma®技術は、マイクロ流路チップの接合やバイオセンサーの開発など、医療・ライフサイエンス分野にも広がっています。迅速な診断や高度な分析を可能にするデバイスづくりを通じて人々の健康と豊かな生活に寄与していきます。



社名に込められた**材料開発**への想い

Samco（サムコ）

Samcoは、**Semiconductor And Materials CO**mpany の頭文字を取った名前です。

「半導体と**材料開発**の分野で躍進する」という想いが込められています。

Semiconductor
And
Materials
COmpany

薄膜技術で世界の産業科学に貢献する

Mission

経営理念

- 企業の永続的な発展を追求し、適正な利益を確保することにより、企業を取巻く利害関係者とともに**成長する**企業を目指して、**薄膜技術で世界の産業科学に貢献する**。

経営方針

1. 社員の**創造**性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。
2. **直販体制**を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。
3. 事業が社会に果たす役割を積極的に認識し、**高い付加価値**を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。

Vision

1. **世界中で自由に**ビジネスを展開し、自社の独自技術を活かし、質の高い製品とサービスを提供し続ける。
2. コア技術（**薄膜技術**）をベースに、参入障壁の高い領域において、特定の製品で圧倒的シェアを有することで、**自ら製品に値付けが出来る力**を持ち、**高い収益率**を維持し続ける。
3. 売上の規模を求めるだけでなく、**継続的に利益を稼げる市場**に特化、集中する。
4. 組織体制は**少数精鋭のプロ集団**である。
5. 適正な税金を納め、**国家や地域の発展にも貢献**する。

Code of Conduct

勇気

前向きな気持ちで**積極的に取り組む姿勢**です。失敗を恐れず、自発的に**チャレンジする気持ち**を大切にしています。

創造

知恵と知識を生かして**世の中**にないモノや仕組みを生み出すことです。創造はその大小を問いません。毎日の小さな創造が、将来予測の困難な時代を**生き抜く大きな力**になります。

勤勉

不断的努力を惜しまない**実直に学び続ける姿勢**です。世の中にあるモノを生み出すには、世の中にあるモノを知らないといけません。そのためには常に学ぶことが必要です。

Philosophy

小さい

コンパクトでなるべく小さく。十分な設置スペースがない研究機関などでも使える製品づくりを行っています。

環境に
優しい

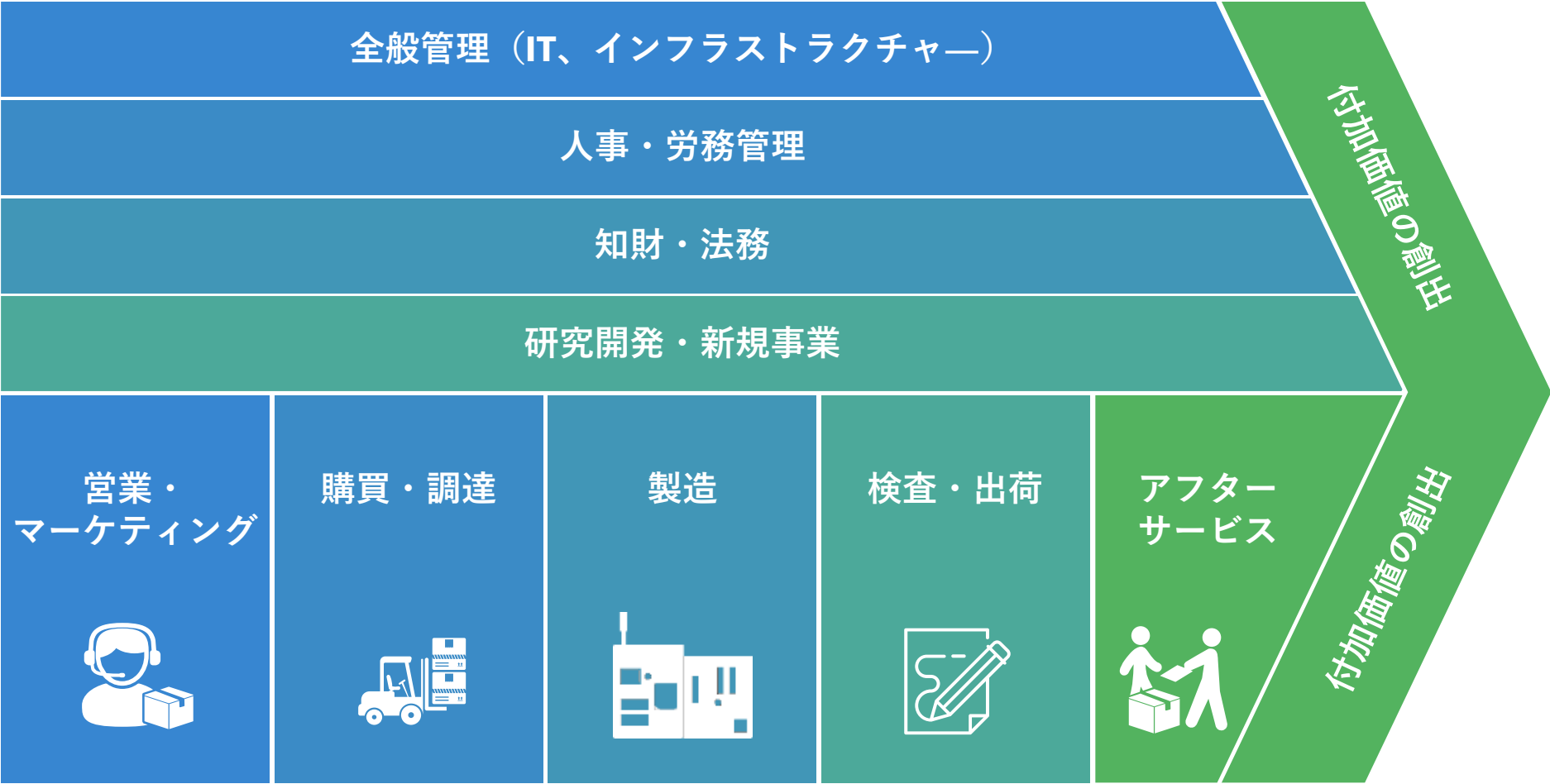
原料にガスではなく**液体を用いたLSCVD®**法や水蒸気を用いた**Aqua Plasma®**など 環境負荷を抑えた技術を開発しています。

高付加
価値

大量生産はしない。**知恵や知識**を活かし、世の中になかった製品をつくり、**高い付加価値**を創出します。

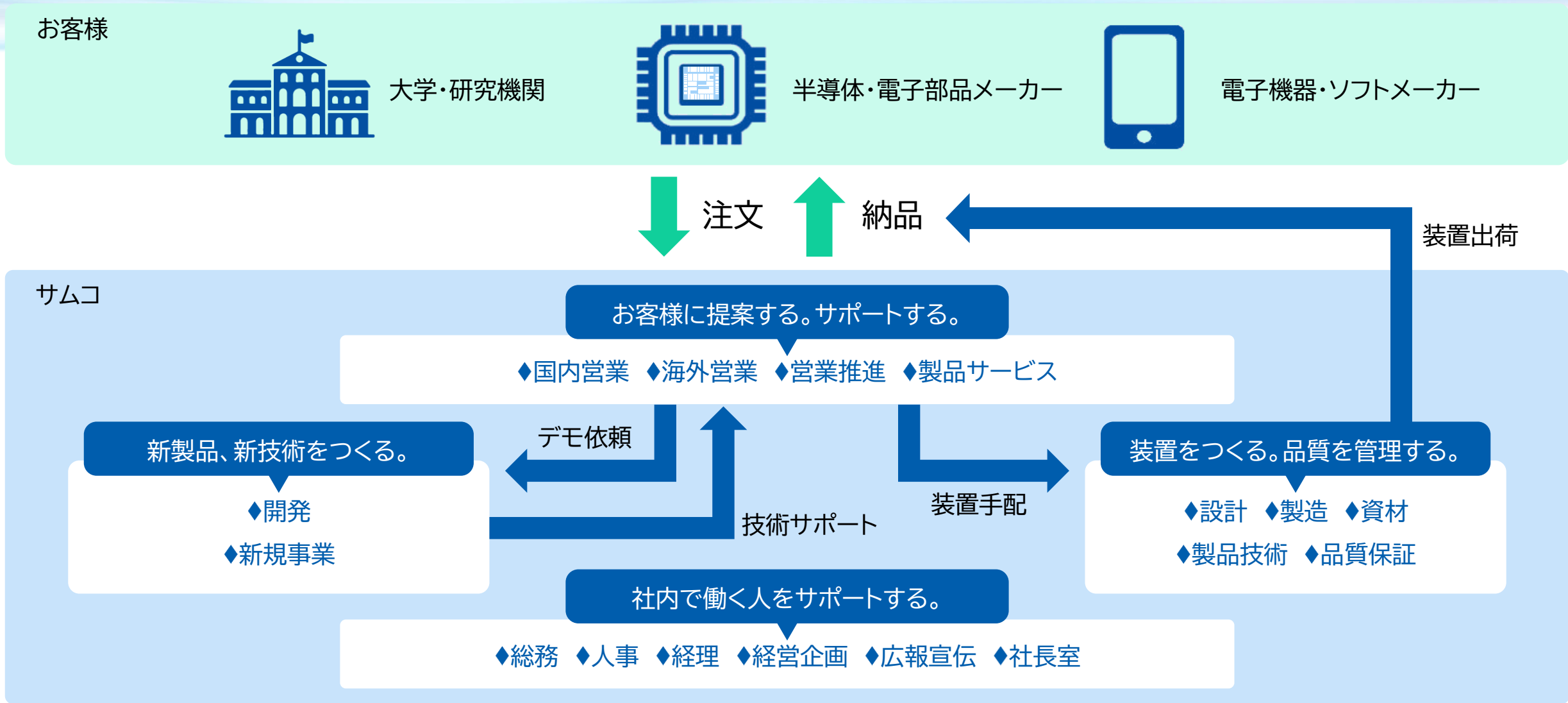
バリューチェーン

支援活動



主活動

職種相関図



ファブライト：生産を外部委託

設計・調達

製造・組み立て

調整・検査

出荷

サムコ

協力会社



購入部品・
製作部品
リスト・
図面等は内製



ファブライト

製造・組み立て・電気配線など
信頼のおける外部の協力会社へ委託



ソフトのインストール・出荷
検査・最終調整は社内

標準装置

装置によっては **70** %近く協力会社で完成

特注装置

特注装置は、社内で協力会社と連携して製造



サムコの次世代研究開発の 中核拠点

- 中期経営計画において重点課題と位置付けるクラスターツールシステムの拡販のための研究開発機能をさらに充実させるため建設。
- 180 m²のクリーンルームはクラス1,000（米国連邦規格）の清浄度で、ポンプ類はバックヤードに設置し、パーティクルの発生を抑え、生産工場と同じ環境で開発

日本国内拠点

京都



本社



研究開発センター



第二研究開発棟



先端技術開発棟



製品サービスセンター



生産技術研究棟



第二生産技術研究棟



▶ 事業拠点 | サムコ株式会社 (samco.co.jp)

本社周辺のアクセスマップやGoogle mapのご案内はこちら

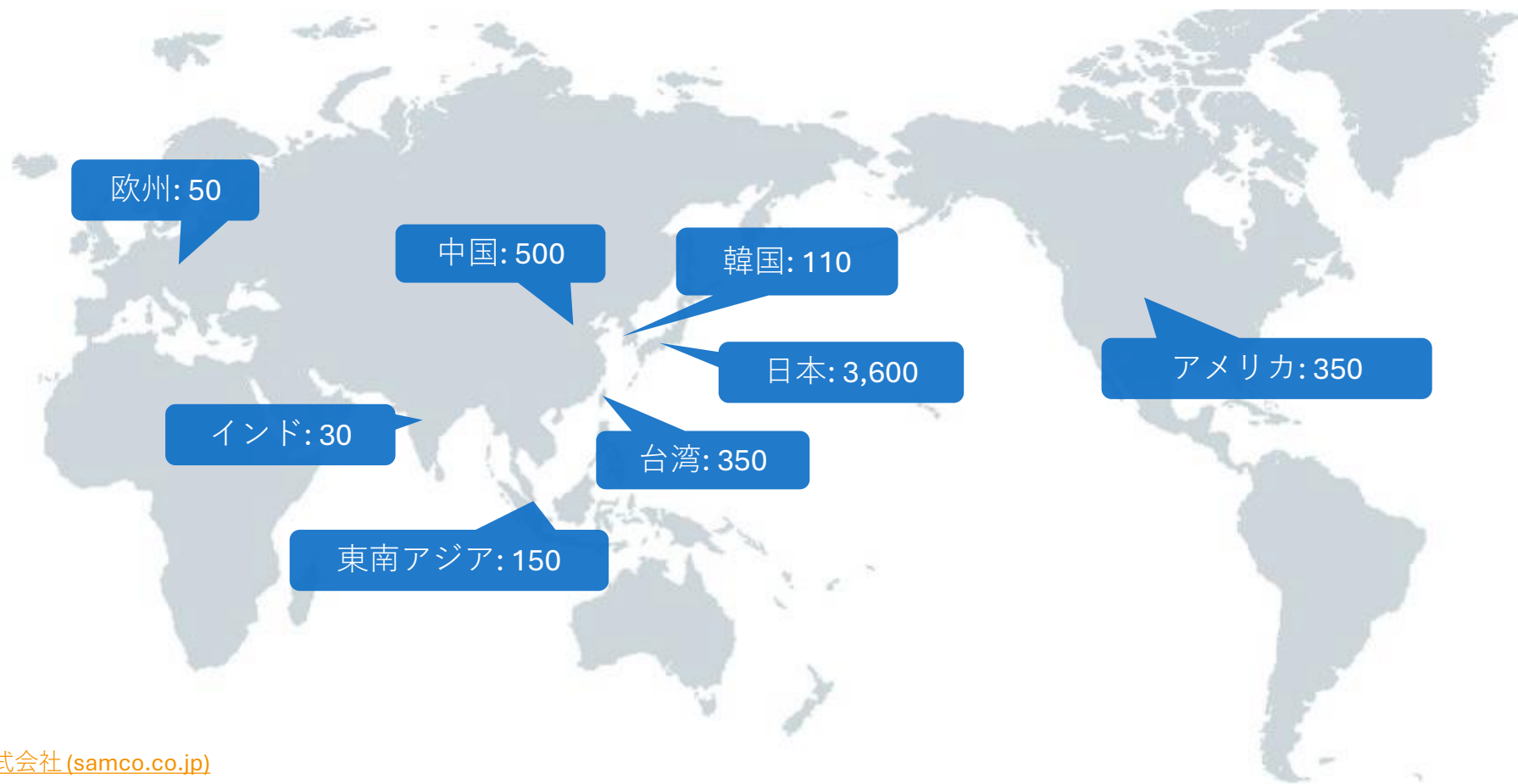
海外営業・サービス拠点（11拠点）



▶ [事業拠点 | サムコ株式会社 \(samco.co.jp\)](https://samco.co.jp)

海外拠点の住所やGoogle mapのご案内はこちら

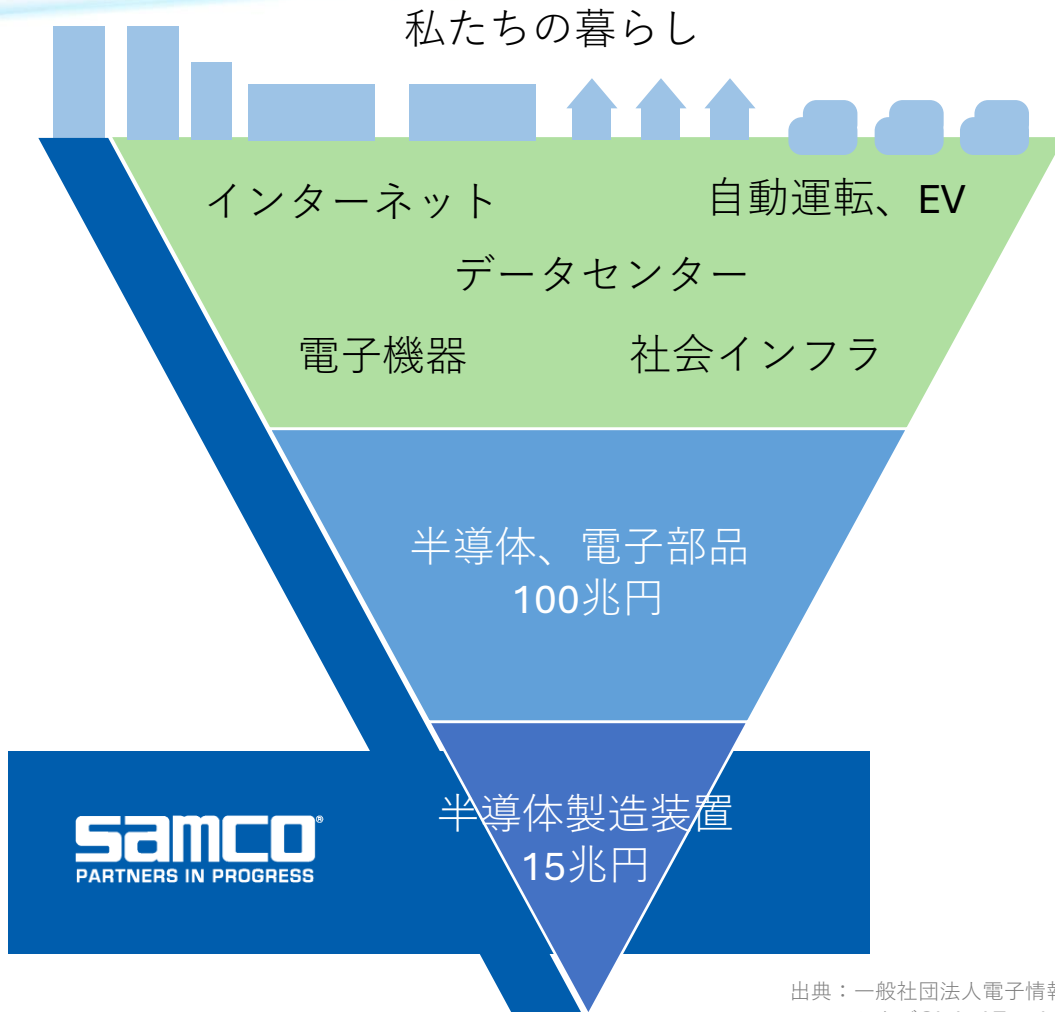
世界37ヵ国 5,000台以上の販売実績



▶ [事業拠点 | サムコ株式会社 \(samco.co.jp\)](https://samco.co.jp)

海外拠点の住所やGoogle mapのご案内はこちら

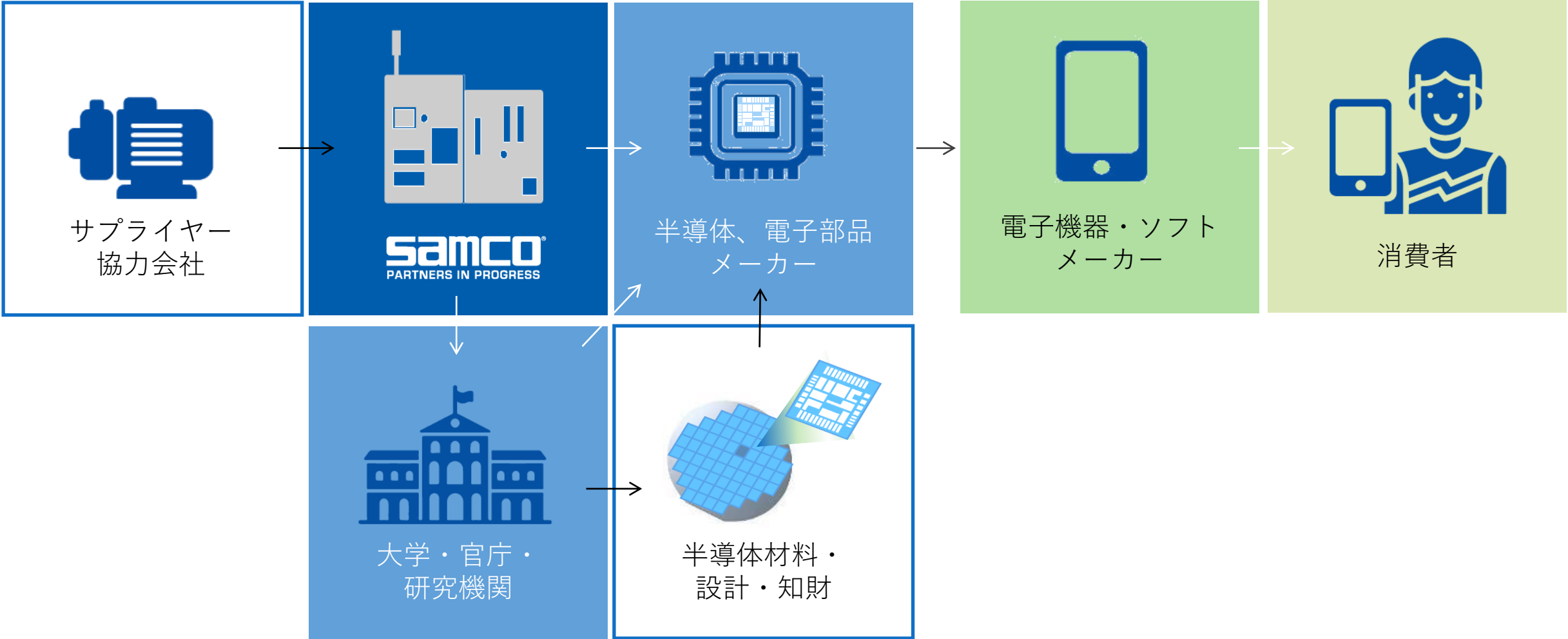
暮らしを支える半導体・電子部品



- 私たちの暮らしは、多くの半導体や電子部品に支えられています。
- 半導体や電子部品を製造するのに不可欠なのが「製造装置」です。
- サムコは独自の製造装置をつくることで、少しでも私たちの暮らしを支えています。

出典：一般社団法人電子情報技術産業協会 JEITA（2021）電子情報産業の世界生産見通し、2021年12月発表
およびGlobal Total Semiconductor Equipment Sales On Track to Record \$118 Billion in 2022, SEMI Reports | SEMI、2022年7月発表

半導体・電子部品業界での立ち位置

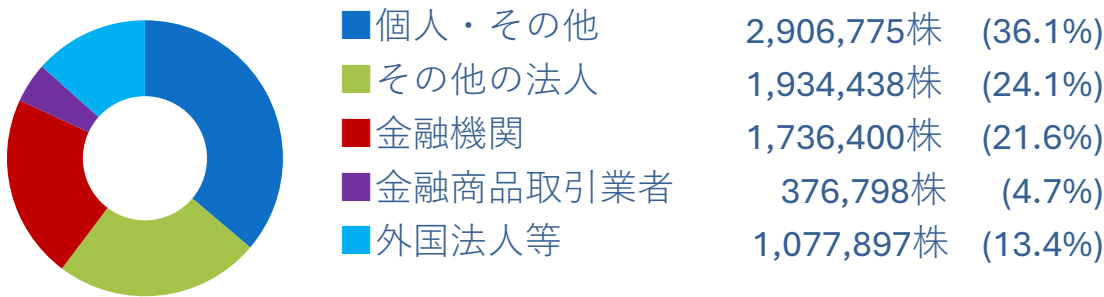


株式の状況（2026年7月末時点）

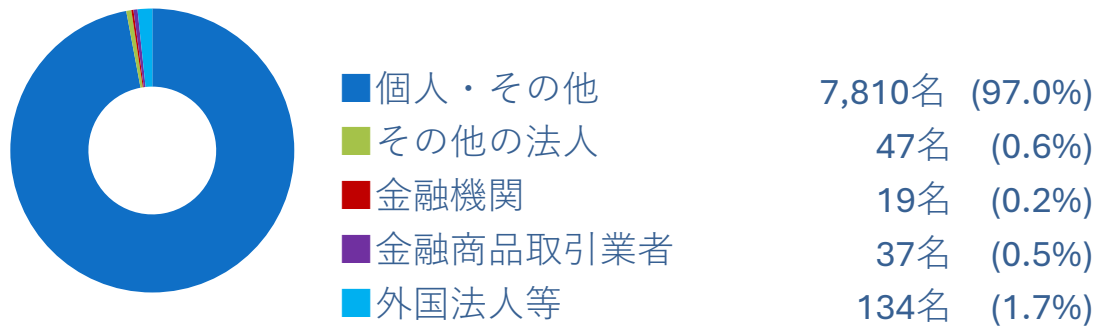
- ・ 発行可能株式総数 14,400,000株
- ・ 発行済株式の総数 8,042,881株
- ・ 株主数 8,048名

株主名	持株数（株）	持株比率（％）
一般財団法人サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
辻 理	861,697	10.7
サムコエンジニアリング株式会社	810,282	10.1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	646,900	8.0
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	274,200	3.4
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行株式会社（投信口）	153,400	1.9
株式会社三菱UFJ銀行	129,600	1.6
野村證券株式会社	124,746	1.6
MSIP CLIENT SECURITIES	124,580	1.5

所有者別株式分布状況（株式数ベース）



所有者別株式分布状況（株主数ベース）



主要数値の変遷

	22/7月期	23/7月期	24/7月期	25/7月期	26/7月期
売上高（百万円）	6,401	7,830	8,203	9,342	10,800
営業利益（百万円）	1,371	1,858	2,017	2,342	3,004
営業利益率（%）	21.4	23.7	24.6	25.1	27.8
経常利益（百万円）	1,481	1,927	2,088	2,373	3,110
当期純利益（百万円）	1,052	1,366	1,471	1,697	2,230
総資産（百万円）	13,379	14,795	16,116	18,205	21,511
自己資本（百万円）	10,057	11,144	12,299	13,852	15,625
自己資本比率（%）	75.2	75.3	76.3	76.1	72.6
ROE（%）	10.8	12.9	12.6	13.0	15.3
減価償却費（百万円）	76	57	83	81	131
設備投資額（百万円）	234	33	276	456	200
研究開発費（百万円）	255	242	262	302	378
EPS（円）	131.07	170.07	183.25	211.27	277.73
配当金（円）	35	45	45	60	75

ESG・サステナビリティ



脱炭素社会を薄膜技術で支える

Sustainability

事業を
通じて

省エネに貢献するパワー半導体や太陽電池の製造にサムコの装置は貢献しています。また、環境負荷を抑えた製品づくりを行っています。

ESG^{※1}
委員会

気候変動にかかわるリスクおよび機会、事業活動や収益に与える影響についてのデータ収集と分析を行う「**ESG委員会**」を設置しています。

TCFD^{※2}
気候変動に関連した情報開示

ESG委員会より、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標について、**HPに開示します。**

※1 ESG:環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字をとった略称。

※2 TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略称。G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融安定理事会（FSB）により2015年に設立。

本資料の著作権その他の一切の権利は、サムコ株式会社に属しております。複製、転送、第三者への配布等を行わないようお願い申し上げます。

持続可能な社会の実現に向けて サムコの取り組み

経営理念 ～薄膜技術で世界の産業科学に貢献する～	
E 環境	＜＜気候変動・脱炭素への取り組み＞＞ ・TCFD提言に基づいた情報開示。ESG委員会の活動による気候変動への対応状況把握、対策。 ・環境方針（2006年制定）に沿った取り組みを実施。 ＜＜環境配慮型製品＞＞ ・省エネ・脱炭素を支えるLED、レーザー、次世代パワーデバイスの製造などを支える装置メーカー。 ・コア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに世界中の製造現場や研究者へ装置を提供。 ・主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減
S 社会	＜＜事業を通じた社会的価値の創造＞＞ ・顧客価値、取引先価値、社会的価値、株主価値、従業員価値の創造 ＜＜社会貢献、地域貢献＞＞ ・サムコ科学技術振興財団による若手研究者への支援活動 ・京都工繊繊維大学への寄附講座、東高瀬川ビジネスコミュニティへの参画 ・従業員、会社からの寄付金活動。（日本赤十字社、京都大学ほか） ・献血活動に協力
G ガバナンス	＜＜ガバナンス体制、ダイバーシティ＞＞ ・役員12名中、社外役員6名（うち女性1名） ・取締役会の実効性評価による改善、検討。 ・多様な人材確保。（女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍）

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

当社が重点的に取り組むSDGs



上記の取り組みに限らず、様々なチャレンジを続けることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

各取り組みの詳細は[こちら](#)

サステナビリティに関する取り組み

取り組みテーマ	概 要
製品容積の減少	半導体製造装置の製造現場では、多大な電力を要するクリーンルームでの効率的な装置配置が不可欠です。そのためには、フットプリントの削減が重要なポイントとなります。更に小さなサイズの装置とすることで納品時における移送コストの削減を行うことができます。
消費エネルギーの削減	より少ない電力消費で当社装置を稼働できるよう省電力が可能となる部品の選択や構成の見直しなどを恒常的に行ってまいります。
会社消費電力量の削減	当社業務活動における電力消費、温室効果ガスの排出量削減を目指した取り組みを行ってまいります。
グリーン調達	当社では、環境に配慮した原材料・部品を優先的に調達するグリーン調達を、調達先企業と協力して推進しております。
廃棄物の削減	事業活動に伴い排出される廃棄物の量の削減・リサイクル製品の利用促進に継続的に取り組んでおります。



気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）

G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融安定理事会（FSB）により2015年12月に設立された「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略称。

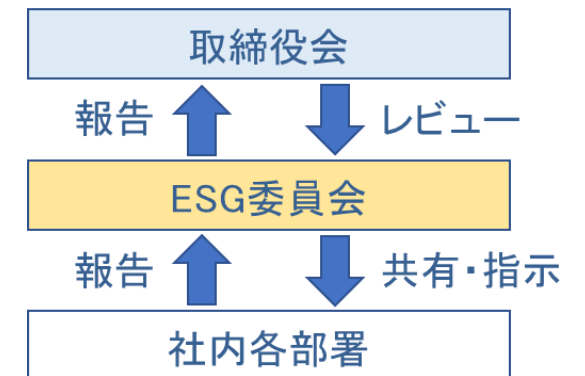
「ESG委員会」より、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標について当社ホームページ上で開示。

ESG委員会

気候変動に係るリスク及び機会、自社の事業活動や収益に与える影響についてのデータ収集と分析を行うため、代表取締役社長を委員長とする「ESG委員会」設置。

⇒活動内容を取締役会に年1回以上報告

⇒財務への影響や中長期経営計画への影響等に対する検討を行う。



省エネ、脱炭素社会実現を支えるサムコの技術



サムコの“薄膜技術”は省エネ・脱炭素を支えるLED、次世代パワーデバイスなどを支えています。

当社のコア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに、SDGsに関連する環境・社会・

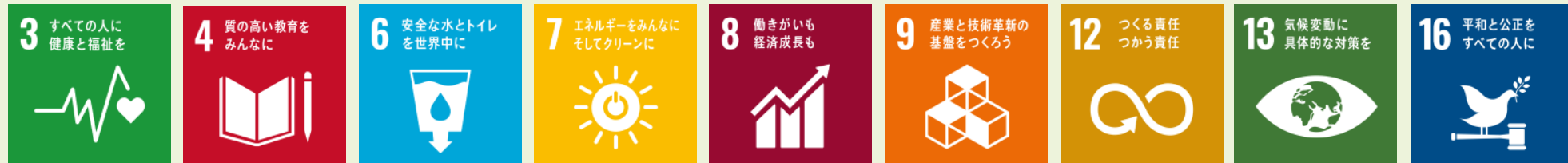
ガバナンスの視点から研究開発、人材育成に注力。

最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

サムコとSDGsの関わり

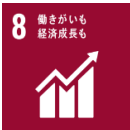
- ・ 当社の主な事業領域である半導体・電子部品製造装置事業は、SDGsの目標を達成するためには欠かせない技術です。
- ・ SDGsの17の目標では、経済、産業、社会等の課題を取り扱っていますが、当社では、創業以来、「企業の永続的な発展を追究し、適正な利益を確保することにより、企業を取巻く利害関係者と共に成長する企業を目指して、薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。」という経営理念を掲げて、社会への貢献に重きを置いてきました。

事業との関連性が高い以下の項目について、重点的に取り組んでまいります。

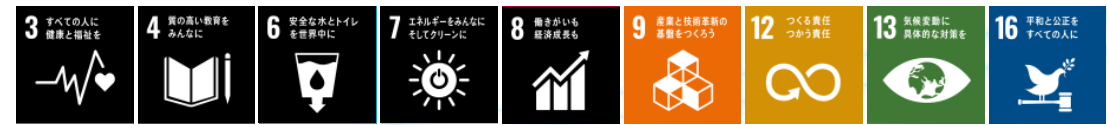


サムコのSDGsの取り組み例



 3 すべての人に健康と福祉を	・ マイクロ流体チップ、医療用ドライ滅菌装置の製造に当社アクアプラズマ技術の寄与を目指す。 ・ 深紫外LED空気清浄機（コロナウィルス不活性化）製造に当社装置が寄与。 ・ 医療機器、エコーヘッドセンサーの製造に当社装置が寄与。 ・ 日本赤十字社への寄付。（ウクライナ人道危機救援金、能登半島地震災害義援金、トンガ大津波支援等）
 4 質の高い教育をみんなに	・ 国内外の大学（ODA案件を含む）・研究機関等における医療分野や科学分野の研究のために、幅広く当社装置を提供。 ・ サムコ科学技術振興財団を通じ、基礎・応用研究に携わる若手研究者を支援。 ・ 京都工芸繊維大学にサムコ辻理寄附講座「先端材料科学講座」を開講。
 6 安全な水とトイレを世界中に	・ 浄水場・家庭・職場・レストラン等での流水浄化用に水銀ランプの代替光源として、深紫外線LEDを利用した浄水器が製造。 ・ 深紫外線LEDの製造に当社装置が寄与。
 7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	・ 省エネの切り札である次世代パワーデバイスの材料として期待されるSiC（炭化シリコン）、GaN（窒化ガリウム）、酸化ガリウム（Ga₂O₃）等の加工に当社装置が寄与。 ・ 高効率LED素子、マイクロLEDや、LD（レーザー）の製造のほか、太陽電池の研究開発用で当社装置を提供。
 8 働きがいも経済成長も	・ 当社はファブライツ企業として、サプライヤーや協力工場と協業し、双方の事業発展を目指す。 ・ 勤続年数に応じた表彰のほか、業績への貢献に応じた賞を用意。 ・ 役職ごとの当社独自の人材育成プログラムを実施。 ・ 多様な人材確保。 （女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍）

サムコのSDGsの取り組み例



 9 産業と技術革新の基盤をつくろう	産業と技術革新の基盤造りのため、以下の用途等に装置を提供 ・5G関連の高周波フィルター、高周波デバイスの製造やデータセンターなどVCSEL（面発光レーザー）を含む通信用LD（レーザー）用装置の製造。 ・自動運転用のセンシング技術（LiDAR）、各種センサーや宇宙衛星の探索用センサー機器の製造。 ・有機EL、マイクロLEDの製造。 ・超伝導デバイス、量子デバイスの研究開発用途。
 12 つくる責任 つかう責任	・人の健康や環境を守るために当社での製造過程、製品について適正な管理を実現する。 ・環境に調和するプロセス技術の開発と、製造から廃棄までを考慮した環境負荷軽減型の製品開発に努める。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。 主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減
 13 気候変動に具体的な対策を	・調達する原材料、部品について、環境影響を考慮するよう調達先に働きかけ、グリーン調達に注力。 ・エネルギーの効率的な利用および3Rに取り組む。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。
 16 平和と公正をすべての人に	・コーポレートガバナンス・コードに基づいた経営を実践。 ・管理職、新入社員を対象にしたコンプライアンス研修を定例的に実施。 ・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、内部統制システムの構築、維持、向上を推進。

サムコの人材育成方針



1. 仕事は楽しく、面白くあるべきである。一所懸命に楽しく仕事をして、かつ面白い。そして良い結果がついてくる。
そんな楽しく、面白い日々が日常である会社とする。
2. “学ぶ”を忘れない。学ぶことを常に念頭に置き、長きに渡り己を磨くことで自らの価値を高めてほしい。
特に若手社員は30代までに能力向上に勤しむ癖をつけないといけない。
3. リスキリングにより第一線で活躍できるスキルを身に付けることにより、70歳まで働ける企業としていく。シニア社員が十分社会貢献できるよう再教育することを会社の使命と考える。
4. 外国籍社員の採用を増やし、若手社員の海外経験を増やすことによりグローバル人材の育成を図る。
5. 階層別の教育訓練制度（部長塾、課長塾、成長塾）を発展的に継続し、多角的な視野で経営管理できる人材の育成を図る。
6. たえず組織の新陳代謝を図り、新たな細胞（多様な人材）を積極的に登用していく。
人事異動は社員の層を厚くし、組織を重層化する目的もあり、新たな能力の開拓につなげる。
女性社員も大きな戦力として、管理職で活躍をしてもらえるように環境を整備する。

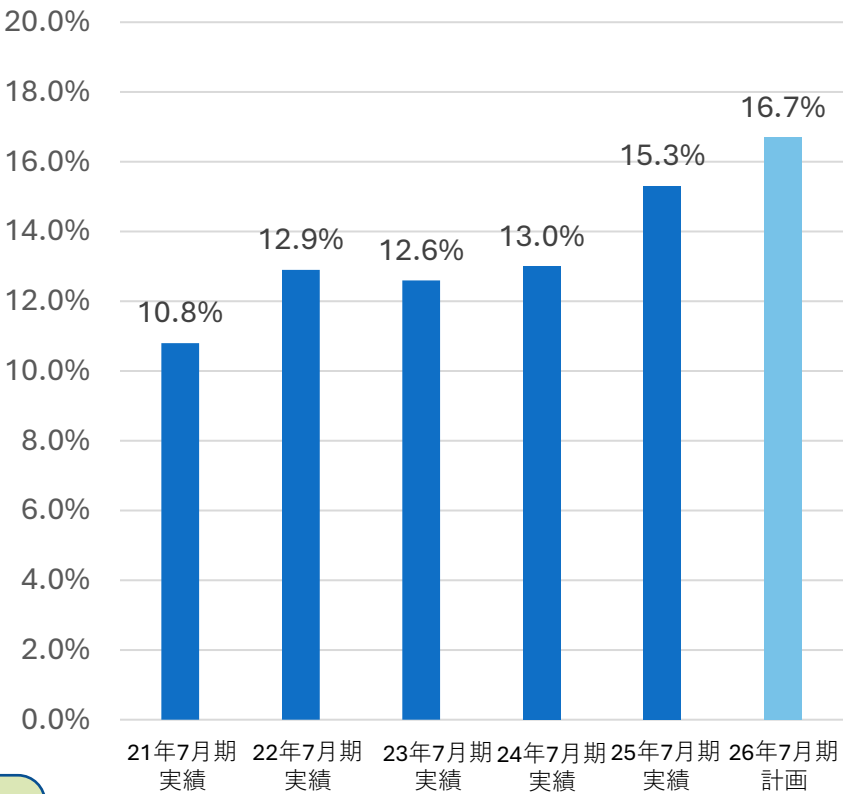


資本コストや原価を意識した経営の実現に向けた対応

当社は、中長期的な経営指標として「装置製造原価率46%以下」「売上高営業利益率25%以上」「海外売上高比率50%以上」を掲げ、収益性と成長性を重視した経営の実現に向け対応しております。

当社の2025年7月期（第46期）のROEは13.0%であり、2026年7月期（第47期）は15.3%となりました。2027年7月期（第48期）の計画は16.7%です。また、「資本コスト」については、その概念や計算方法について統一的な基準が示されておらず、一般的な指標になっていないことより、当社の経営指標や開示情報には用いておりませんが、新規事業等への新たな投資については現状のROE水準を意識した経営を実践しております。

なお、当社の2026年7月31日時点のPBRは4.3倍となっており、株価についても意識した経営を継続いたします。



ROE
(Return On Equity)
自己資本当期純利益率

×

PER
(Price Earnings Ratio)
株価収益率

=

PBR
(Price Book-value Ratio)
株価純資産倍率

コーポレートガバナンス報告書は[こちら](#)

株主・投資家との対話状況

基本方針

当社は、持続的な企業価値の向上のために、株主との間で建設的な対話を行うこととしております。株主との対話につきましては、代表取締役社長 川邊 史の管掌の下、専任部署である経営企画室（2026年7月現在3名）を中心に、経理部、総務部、社長室などの関連部署と密接に連携しつつ、IR活動を行っています。また、対話に際しては内部規定に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底しております。

対話を行った株主の概要 対象期間：2025年8月1日から2026年7月31日までの1年間

【機関投資家・アナリスト向け】

- ・ 1 on 1 ミーティング 166件
- ・ 機関投資家・アナリスト向け オンライン決算説明会 年2回（Zoomウェビナー形式／中間期3月、期末9月）

【個人投資家向け】

- ・ 株主総会後の会社説明会 年1回（10月）
- ・ 第45期 年次報告書（2025年10月）にて株主アンケートを実施し、その結果を第46期 中間期報告書（2026年4月）にて公表。
- ・ 個人投資家からの電話・メール問い合わせ対応 随時

投資家の皆様との建設的な対話を通じ、企業価値向上に繋げてまいりたいと考えております。

その他、対話の実例、取締役会に対するフィードバック、取り入れた事項などはHPに掲載 ⇒ 株主・投資家との対話状況の詳細は[こちら](#)

IRカレンダー



お問い合わせ

サムコ 株式会社

経営企画室

E-mail: kikaku@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



A Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology